

股票简称：先锋精科

股票代码：688605

江苏先锋精密科技股份有限公司

（江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号）



向不特定对象发行可转换公司债券

并在科创板上市

募集说明书摘要

保荐人（主承销商）



华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券；有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，先锋精科主体信用级别为AA_{Sti}，本次可转换公司债券信用级别为AA，评级展望为稳定。

本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司

债券可能因未设定担保而存在兑付风险。

四、公司持股 5%以上股东或董事、高管参与本次可转债发行认购情况

（一）公司持股 5%以上股东的认购情况

1、优立佳合伙、英瑞启、优正合伙

公司持股 5%以上的股东优立佳合伙、英瑞启、优正合伙将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：

“1、如先锋精科启动本次可转债发行，本企业将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购先锋精科本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。

2、如届时本企业决定认购先锋精科本次发行的可转换公司债券的，本企业将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本企业成功认购取得先锋精科本次发行的可转债，本企业将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持先锋精科本次发行的可转债，并遵守中国证监会和上海证券交易所的其他相关规定。

3、本企业将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票或可转债的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。

4、本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺而减持先锋精科股票或可转债的，由此所得收益全部归先锋精科所有，本企业将依法承担由此产生的法律责任。”

2、游利、李欢

公司持股 5%以上的股东游利、李欢将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：

“1、如先锋精科启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购先锋精科本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。

2、如届时本人决定认购先锋精科本次发行的可转换公司债券的，本人将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本人成功认购取得先锋精科本次发行的可转债，本人承诺：本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持先锋精科本次发行的可转债，并遵守证监会和上海证券交易所的其他相关规定。

3、本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票或可转债的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。

4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人或本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持先锋精科股票或可转债的，由此所得收益全部归先锋精科所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。”

（二）公司董事、高管参与本次可转债的认购情况

公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：

“1、如先锋精科启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购先锋精科本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。

2、如届时本人决定认购先锋精科本次发行的可转换公司债券的，本人将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本人成功认购取得先锋精科本次发行的可转债，本人承诺：本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发

行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持先锋精科本次发行的可转债，并遵守证监会和上海证券交易所的其他相关规定。

3、本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票或可转债的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。

4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人或本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持先锋精科股票或可转债的，由此所得收益全部归先锋精科所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。”

公司独立董事不参与本次可转债认购，并出具承诺：

本人及本人配偶、父母、子女承诺不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购，并自愿接受本承诺函的约束。如本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）行业周期性风险

公司所处的半导体设备精密零部件行业是半导体行业上游，半导体行业的整体发展情况会对公司所处行业产生较大影响。受扩产周期、创新周期等因素的叠加作用，半导体行业具有典型的周期性特点，通常每 4-5 年完成一轮周期波动，呈螺旋式上升的特点，其中 2-3 年处于上行通道，3-6 个季度处于下行通道。在经历了 2021-2022H1 的较快增长后，2022H2 由于下游消费电子需求疲软，产能紧张时期的供应链库存累积，全球半导体市场进入下行周期，该下行周期在 2023 年下半年起逐渐复苏，并在 2024 年重新进入上升周期。

在行业处于周期性上行通道时，公司需要保持及提高产能来满足产业链下游客户快速提升的需求。若公司不能及时应对客户需求的快速增长，可能会导

致公司失去既有或潜在客户；在行业处于周期性下行通道时，计算机、消费电子等终端消费市场需求下降，晶圆厂继而削减资本性支出，对公司产品的需求亦可能下降。

虽然长期看，半导体行业作为电子信息产业的基石，人类社会智能化、数字化的大趋势将继续演进，半导体行业的长期需求将持续向好，但在行业处于周期性下行通道时，因晶圆制造企业、半导体设备企业削减资本性支出，公司新增订单可能出现下滑，进而影响公司的经营业绩。

（二）半导体功能器件拓展风险

报告期内，发行人收入主要来自于半导体精密零部件，以不带功能的关键工艺部件和工艺部件为主，功能器件收入占比较少。以晶圆加热器为代表的功能器件是发行人对现有精密零部件业务板块产品的丰富、延伸和升级，系围绕现有主营业务展开。发行人基于产品专精的特点，能够将零部件生产制造技术和经验进一步推广至功能器件。

虽然发行人具备研发和量产功能器件对应的人员、技术能力和生产能力，并已经过较长时间的研发积累，但由于发行人在相关产品的人员储备相对不足、先进陶瓷生产工艺尚未完全成熟、新产品开发成本较高，如未来发行人功能器件相关产品市场拓展不及预期，将对发行人盈利能力产生不利影响。

（三）业绩及毛利率下降的风险

报告期内，公司的营业收入分别为 55,771.69 万元、113,577.41 万元、123,772.76 万元和 28,358.50 万元，2023-2025 年复合增长率为 48.97%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 7,978.54 万元、21,373.27 万元、18,608.72 万元和 2,486.44 万元，公司主营业务毛利率分别为 29.13%、33.36%、28.59%和 25.19%。

2025 年度，发行人营业收入同比增长 8.98%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降 12.93%，主要原因系主营业务毛利率同比下降 4.77%，主营业务毛利率下降的主要原因系：1、公司根据市场需求及发展规划进行了适度的产能预增，2025 年度，新增产能所需的基础建设和生产能力已逐步启用，但下游行业在经历 2023 年下半年、2024 年扩产后进入新增产能

消纳阶段，下游客户需求阶段性放缓，发行人新增产能未得充分吸收；2、为应对下游客户需求，当年员工规模同比提高，导致薪酬支出增加；3、随着国产半导体设备向先进制程迭代，下游半导体厂商对产品质量要求日益严苛，发行人在多工序、各环节加强质量管控，成本相应上升。

2026年1-3月，发行人营业收入同比下降5.46%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降39.51%，主要原因除导致2025年度主营业务毛利率下降的因素延续外，还包括：1）受行业阶段性下行带来的客户延期交付影响，公司存货金额增加、库龄有所延长，计提的存货跌价准备上升，计入当期损益的资产减值损失相应增加；2）发行人用于外销结算的主要货币为美元，2025年一季度，人民币对美元汇率较为稳定，2026年一季度，受宏观环境影响，美元对人民币持续贬值，带来大额汇兑损益；3）计入当期损益的政府补助和进项税加计抵减金额下降。

如果未来发生市场竞争加剧、宏观经济景气度下行、国家产业政策变化、公司不能有效拓展国内外新客户、下游客户投资需求发生波动、研发投入未能及时实现产业转化等原因导致产能利用率下降，公司主营业务毛利率将下降，公司将面临一定的经营压力，未来业绩存在大幅波动甚至出现亏损的风险。

（四）募集资金用于拓展新产品的风险

本次募投项目中，“半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目”产品主要为陶瓷加热器，系公司基于现有半导体精密零部件业务所拓展的新材质产品。目前，该项目的产线投建、产品研制、客户验证及销售等均处于相对早期阶段，若公司最终无法顺利建设新材质功能器件产线并实现量产，或新产品无法及时通过下游客户验证、受技术迭代影响市场需求及单价下降等，该募投项目可能存在实施失败、新增产能无法消化等风险，进而对公司业绩产生不利影响。

（五）募投项目研发失败的风险

本次募集资金投资项目“半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目”的研发方向为静电吸盘。静电吸盘为半导体设备核心高端零部件，行业在精密加工、分区温控、表面处理及洁净制造等环节存在较高技术壁垒，项目研发难度大、周

期较长、资金投入较高。若公司在研发过程中未能攻克关键核心技术、研发进度不及预期，或研发成果无法满足下游客户严苛认证要求、技术路线与行业发展趋势不匹配，将导致项目研发失败。项目研发失败可能使公司无法实现预期研发及产业化目标，前期投入难以收回，进而对公司技术布局、产品拓展及经营业绩产生不利影响。

（六）募投项目未能按期完成或不能达到预期收益的风险

本次募集资金将投资于半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目、半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目和半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目，募投项目涉及现有产品产能扩建、新产品拓展、技术研发等环节，对公司的技术、组织和管理提出了较高的要求。本次募投项目主要以当前的国家政策导向和市场发展趋势为基础，结合公司目前业务经验积累的研发技术而做出，然而随着集成电路产业和半导体设备行业的快速发展，公司可能面临来自市场变化、技术革新、运营管理等多方面的挑战，如若公司处理不当，募投项目存在不能达到预期收益或新增产能难以消化的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（七）募投项目产能消化风险

公司本次募集资金投资项目的实施将会新增金属加热器、陶瓷加热器的产能，相关产品主要应用于薄膜沉积设备等半导体核心设备。

当前半导体陶瓷加热器的主要市场份额主要由 NGK、MiCo 等境外龙头厂商占据，中国境内优秀企业如珂玛科技等已经实现对下游客户的批量销售，但相关产品在国内尚处于起步阶段。在国产半导体设备供应链安全需求下，本土厂商的导入和验证将提速，由此半导体陶瓷加热器将迎来广阔发展空间。此外，本土同行业公司也在导入金属加热器产能。

公司本次募投募集资金投资项目虽经过市场分析和论证，但考虑到境外优势半导体陶瓷领先企业和本土同行业公司相关产品产业化投入的形势下，募投产品在未来市场竞争中可能面临产销率不及预期的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

六、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况

（一）公司利润分配政策

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规对于利润分配政策的规定以及《公司章程》的规定，公司的利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

2、利润分配的方式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司具备现金分红条件的，应当优先以现金方式进行股利分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、利润分配的期限间隔

公司在符合《公司章程》规定的利润分配条件时，原则上每年度进行一次现金分红；在有条件的情况下，根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红。

4、现金分红的具体条件和比例

公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，且经营性现金流可以满足公司正常经营和可持续发展且足以支付当期利润分配，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

满足公司章程规定的现金分红的条件下，且公司如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，则公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%；重大投资计划或重大资金支出是指公司在一年内拟购

买资产以及对外投资等交易涉及的累计支出超过最近一期经审计净资产的 10% 或者资产总额的 5%。

同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、发放股票股利的具体条件

如果有扩大股本规模的需求，或发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足公司章程规定的现金分红的条件下进行股票股利分配；采用股票股利分配方式的将结合公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

6、公司利润分配的决策机制和程序

（1）公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划制定，董事会对利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。

（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

（3）独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，

有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。审计委员会应对利润分配预案提出审核意见。

公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。

（4）利润分配预案经审计委员会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东会审议。股东会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。

（5）公司年度盈利且可供分配利润为正数但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途。

7、利润分配政策调整的决策机制与程序

（1）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或现行利润分配政策确实与公司生产经营情况、投资规划和长期发展目标不符的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策的提案中应详细说明调整利润分配政策的原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

（2）公司至少每三年对已实施的分红回报规划的执行情况进行一次评估，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，决定是否对公司正在实施的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。

（3）公司董事会在审议调整利润分配政策时，必须经全体董事的过半数表决同意通过。审计委员会在审议利润分配政策调整时，须经全体审计委员会成员过半数表决同意通过。

（4）利润分配政策调整应当分别经董事会和审计委员会审议通过后方能提交股东会审议。股东会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决同意。公司股东会审议利润分配政策调整事项时，应

当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东会提供便利。

（二）本次发行前后公司利润分配政策变化情况

本次可转债发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

（三）最近三年利润分配情况

最近三年内，公司利润分配情况如下：

1、2025 年度利润分配情况

公司 2025 年度现金分红总额为 2,023.80 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为 10.71%。

2、2024 年度利润分配情况

公司 2024 年度现金分红总额为 4,047.60 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为 18.92 %。

3、2023 年度利润分配情况

2023 年度，公司未进行利润分配。

4、公司最近 3 年利润分配情况

公司 2023 年至 2025 年利润分配情况如下所示：

单位：万元、%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	18,889.58	21,394.62	8,027.50
现金分红金额（含税）	2,023.80	4,047.60	-
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	10.71	18.92	-
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-	-	-
各年现金分红金额小计（含税）	2,023.80	4,047.60	-
最近三年现金分红金额小计（含税）	6,071.40		
最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润	16,103.90		
最近三年现金分红金额占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比率	37.70		

综上，公司利润分配情况符合公司章程及股东回报规划的要求。

（四）公司最近三年未分配利润使用安排情况

为保持公司的可持续发展，公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常的生产经营，以支持公司未来战略规划和可持续性发展。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

目 录

声 明	2
重大事项提示	3
一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股 的风险	3
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级	3
三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项	3
四、公司持股 5%以上股东或董事、高管参与本次可转债发行认购情况	4
五、特别风险提示	6
六、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况	10
目 录	15
第一节 释义	17
第二节 本次发行概况	23
一、公司基本情况	23
二、本次发行的基本情况	23
三、本次发行可转债的基本条款	28
四、本次发行的有关机构	40
五、发行人与本次发行有关的中介机构的关系	41
第三节 发行人基本情况	43
一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况	43
二、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况	43
第四节 财务会计信息与管理层分析	46
一、审计意见	46
二、财务报表	46
三、发行人合并财务报表范围及变化情况	51
四、主要财务指标	52
五、会计政策变更和会计估计变更	54
六、财务状况分析	56

七、经营成果分析	76
八、资本性支出分析	92
九、技术创新分析	93
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项	101
十一、本次发行的影响	102
第五节 本次募集资金运用	103
一、本次募集资金投资项目计划	103
二、本次募集资金投资项目的具体情况	103
三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式	121
四、本次募集资金投资项目的资本化情况	123
第六节 备查文件	125

第一节 释义

在募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一、一般术语		
《募集说明书》	指	《江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》
发行人、公司、本公司、先锋精科	指	江苏先锋精密科技股份有限公司
靖江先捷	指	靖江先捷航空零部件有限公司，为发行人子公司
无锡先研	指	无锡先研新材料科技有限公司，为发行人子公司
先锋精密（新加坡）	指	Sprint Precision Technologies （Singapore）PTE. LTD.,为发行人子公司
无锡至辰	指	无锡至辰科技有限公司，为发行人孙公司
ULYC（新加坡）	指	ULYC PTE. LTD., 为发行人前孙公司，已注销
ULYC（香港）	指	ULYC（HONG KONG）PTE. LTD.,为发行人控股股东、实际控制人游利曾控制的企业，已注销
首发募投项目	指	发行人首次公开发行股票募集资金投资项目
优立佳合伙	指	靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人持股 5%以上的股东
英瑞启	指	上海英瑞启技术咨询有限公司，曾用名“连云港英瑞启技术咨询有限公司”，为发行人持股 5%以上的股东
优正合伙	指	靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人持股 5%以上的股东
优合合伙	指	靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东
中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司及其合并范围内子公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688012.SH，为发行人客户、股东
北方华创	指	北方华创科技集团股份有限公司及其合并范围内子公司，深圳证券交易所主板上市公司，股票代码为 002371.SZ，为发行人客户
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司及其合并范围内子公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688981.SH，为发行人客户
拓荆科技	指	拓荆科技股份有限公司及其合并范围内子公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688072.SH，为发行人客户
华海清科	指	华海清科股份有限公司及其合并范围内子公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688120.SH，为发行人客户

屹唐股份	指	北京屹唐半导体科技股份有限公司及其合并范围内子公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688729.SH ，为发行人客户
微导纳米	指	江苏微导纳米科技股份有限公司及其同一控制下公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688147.SH ，为发行人客户
中硅泰克	指	北京中硅泰克精密技术有限公司及其同一控制下公司，为发行人客户
富创精密	指	沈阳富创精密设备股份有限公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688409.SH ，为发行人同行业公司
珂玛科技	指	苏州珂玛材料科技股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码为 301611.SZ ，为发行人同行业公司
托伦斯	指	托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司，深圳证券交易所创业板 IPO 注册生效，为发行人同行业公司
NGK	指	NGK 株式会社，半导体陶瓷加热器、静电吸盘（ESC）等高端功能器件领域的国际龙头企业，东京证券交易所上市公司，股票代码为 5333.T
MiCo	指	MiCo Co., Ltd.，全球半导体先进陶瓷器件领域的重要供应商，韩国科斯达克上市企，股票代码为 059090.KS
靖江佳仁	指	靖江佳仁半导体科技有限公司，报告期内曾经存在的关联方，已注销
佳佳精密	指	靖江佳佳精密机械科技有限公司，为发行人关联方
靖江顺希	指	靖江市顺希再生资源回收有限公司，报告期内曾经存在的关联方，已注销
靖江佳晟	指	靖江佳晟真空技术有限公司，为发行人关联方
大晟航空	指	靖江大晟航空科技有限公司，报告期内曾经存在的关联方
股东会	指	江苏先锋精密科技股份有限公司股东会
董事会	指	江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
本次发行	指	本次向不特定对象发行可转换公司债券
可转债	指	可转换公司债券
《公司章程》	指	《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》
最近三年	指	2023 年度、2024 年度及 2025 年度
报告期、三年一期		2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-3 月
报告期各期末	指	2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 3 月末
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
保荐人、保荐人（主承销商）华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元、资信评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
二、专业术语		
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间、加热后可实现单向导通的材料
集成电路（IC）	指	Integrated Circuit ，指将一定数目的三极管、二极管、电阻、电容和电感等集成在一个芯片里，从而实现电路或者系统功能的电路或系统
硅片	指	用以制作芯片的圆形硅晶体半导体材料，又称裸晶圆
晶圆	指	在裸晶圆上通过氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、清洗与抛光、金属化等特定工艺加工形成的具有特定电性功能的集成电路产品
芯片	指	集成电路载体，是集成电路经设计、制造、封装、测试后的结果
先进制程、成熟制程	指	晶体管中栅极的宽度（也成制程）。宽度越窄，晶体管就越小，电流通过时的损耗越低，性能也越高，制造工艺也更复杂。先进制程指 7nm 及以下制程，成熟制程指大于 7nm 制程。
半导体设备	指	用于光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、清洗与抛光、金属化等半导体器件（主要为集成电路产品）制造环节的生产设备
光刻	指	光刻是平面型晶体管和集成电路生产中的一个主要工艺。是对半导体晶片表面的掩蔽物（如二氧化硅）进行开孔，以便进行杂质的定域扩散的一种加工技术
离子注入/扩散	指	微电子工艺中的一种重要的掺杂技术，在真空中、低温下，把杂质离子加速，离子束与材料中的原子或分子将发生一系列物理的和化学的相互作用，从而优化材料表面性能，或获得某些新的优异性能
退火	指	一种金属热处理工艺，指的是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却。该工艺可实现降低硬度、去除金属内部应力、改善切削加工性、稳定尺寸、减少变形与裂纹倾向等作用
刻蚀	指	半导体前道工序之一，用化学或物理方法有选择地在晶圆表面去除不需要的材料的过程，是与光刻相联系的图形化处理的一种主要工艺，是半导体制造工艺的关键步骤
薄膜沉积	指	半导体前道工序之一，半导体制造中任何在硅片衬底上沉积一层膜的工艺，这层膜可以是导体、绝缘物质或者半导体材料。薄膜沉积设备主要包括 PVD （物理气相沉积）、 CVD （化学气相沉积）和 ALD （原子层沉积）设备等，是半导体制造工艺的关键步骤

MOCVD 设备	指	Metal-Organic Chemical Vapor Deposition （金属有机化合物化学气相沉积），是外延片生产的核心设备，是 CVD（化学气相沉积）实现路径中的一种
PECVD 设备	指	Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition （等离子体增强化学气相沉积），CVD 的一种，在沉积室利用辉光放电使其电离后在衬底上进行化学反应沉积的半导体薄膜材料制备和其他材料薄膜的制备方法
切削	指	通过机械设备（一般为数控机床）精确地去除材料，以获得一定形状和尺寸产品的制造方法
表面处理	指	利用物理、化学和热处理等学科的边缘性新技术来改变物体表面的状况和性质，达到清洁零部件、延长零部件使用寿命或改造零部件的目的
阳极氧化	指	金属或合金的电化学氧化，铝及其合金在相应的电解液和特定的工艺条件下，在外加电流的作用下，在铝制品（阳极）上形成一层氧化膜的过程
FSW 搅拌摩擦焊接	指	把一个高速旋转的搅拌工具插入待焊金属之间，并使搅拌工具以一定速度向前运动，通过轴肩及搅拌针的旋转使被焊金属加热到塑性状态，而搅拌工具向前移动，挤压、搅拌塑性材料，使塑性材料形成一个稳定的流场，在搅拌头移过的部位，随着搅拌工具的移动，温度逐渐冷却凝固形成焊缝
AlN 原料	指	氮化铝（ Aluminum Nitride ）粉体 / 坯料，是制备高热导、高绝缘、耐高温氮化铝陶瓷的核心原材料，广泛用于半导体设备、先进封装、晶圆制程关键部件。
静电吸盘（ESC）	指	ESC: Electrostatic Chuck ，即静电吸盘，是半导体刻蚀、薄膜沉积、离子注入等核心设备的关键功能部件，主要用于在真空及等离子体环境下对晶圆进行无损伤吸附固定，并实现高精度温度均匀控制。
ERP/MES 系统	指	企业资源计划与制造执行相结合的信息化管理系统，实现从订单、计划、排产、加工、检验到入库的全流程数字化、可追溯管控，提升生产效率与产品一致性。
PPAP	指	Production Part Approval Process ，即生产件批准程序，是汽车行业、半导体行业通用的零部件准入与质量认证体系，用于确认供应商是否正确理解客户工程设计、规格及质量要求，并具备持续稳定生产合格产品的能力。
APQP	指	Advanced Product Quality Planning ，即产品质量先期策划，是汽车及半导体行业通用的产品开发与质量管控方法，用于在产品研发、工艺设计、量产前进行全流程质量策划、风险预防、过程控制与验证，确保产品满足客户要求并实现稳定交付。
CNC	指	Computer Numerical Control ，即计算机数字控制，指通过计算机程序自动控制机床的坐标运动、切削路径与加工精度，实现高精度、自动化的零部件切削加工。

YF ₃	指	三氟化钇 (Yttrium Fluoride)，高纯稀土氟化物材料，具备优异耐氟基等离子体腐蚀性能，主要用于半导体刻蚀设备腔体、内衬等部件的抗腐蚀涂层制备。
YOF	指	氟氧化钇 (Yttrium Oxyfluoride)，氧化钇与氟化钇的复合陶瓷材料，兼具耐高温、高致密度与优异抗等离子体腐蚀性能，是先进制程设备核心防护涂层材料。
YAG	指	钇铝石榴石 (Yttrium Aluminum Garnet, Y ₃ Al ₅ O ₁₂)，高性能稀土陶瓷材料，具备优良光学与结构稳定性，可用于半导体设备观察窗口及耐等离子体部件。
AD	指	Aerosol Deposition，即气溶胶沉积工艺，一种室温下直接将陶瓷颗粒高速喷射沉积形成致密涂层的技术，用于半导体部件高致密、高结合力防护涂层制备。
APS	指	Atmospheric Plasma Spraying，即大气等离子喷涂，利用高温等离子焰流熔化粉末并高速喷射形成涂层，适用于大面积、厚膜陶瓷涂层制备。
HVOF	指	High Velocity Oxygen Fuel，即高速火焰喷涂，超音速火焰喷涂技术，形成高致密、高结合强度、低孔隙率的金属 / 陶瓷涂层，耐腐蚀性与耐磨性优异。
ALD	指	Atomic Layer Deposition，即原子层沉积工艺，单原子层逐次沉积，可制备超薄、均匀、台阶覆盖率优异的精密薄膜，广泛用于先进半导体制程与涂层。
EUV 光刻机	指	Extreme Ultraviolet Lithography，即极紫外光刻机，采用 13.5nm 极紫外光作为曝光光源，是 7nm 及以下先进制程芯片制造的核心设备。
真空钎焊	指	钎焊过程全部在真空设备中进行，当被连接的零件和钎料加热到钎料熔化时，利用液态钎料在母材表面间隙中湿润、毛细流动并母材相互溶解、扩散从而达到被连接零件间的连接，具有不氧化、无污染、变形小的优点，可实现多道钎缝、多个组件同焊接的高效工艺手段。
电子束焊接	指	将高能电子束作为加工热源，用高能量密度的电子束轰击焊件接头处的金属，使其快速熔融，然后迅速冷却来达到焊接的目的的焊接技术
CNC	指	计算机数字化控制精密机械加工
真空度	指	处于真空状态下的气体稀薄程度，一般单位用 Torr
纳米、nm	指	长度单位，1 纳米=10 ⁻⁹ 米
微米、μm	指	长度单位，1 微米=10 ⁻⁶ 米
Ra	指	衡量表面粗糙度的指标，指在取样长度内，实际表面距平面绝对值的算术平均值，Ra0.1 微米即多个测量点的表面偏离平面间距的平均值在 0.1 微米。

特别说明：

1、本募集说明书摘要部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计

算过程中的四舍五入所形成。

2、本募集说明书摘要中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。

第二节 本次发行概况

一、公司基本情况

中文名称：江苏先锋精密科技股份有限公司

英文名称：Sprint Precision Technologies Co., Ltd.

注册地址：江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号

股票简称：先锋精科

股票代码：688605

股票上市交易所：上海证券交易所

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行数量、证券面值、发行价格或定价方式

本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 75,000.00 万元，发行数量为 750,000 手（7,500,000 张）。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行价格按债券面值发行。

（三）募集资金量（含发行费用）及募集资金净额、募集资金专项存储的账户

本次可转债募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，募集资金净额将扣除发行费用后确定。公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。

（四）募集资金投向

本次可转债募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，扣除发行费用后的募

集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目	30,401.55	28,750.00
2	半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目	26,470.57	25,050.00
3	半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	5,911.37	5,200.00
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		78,783.49	75,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（五）发行方式与发行对象

1、发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年8月5日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

2、发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2026年8月5日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。

(3) 本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

（六）承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，认购金额不足 75,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 75,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 22,500.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行政程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

承销期的起止时间：2026 年 8 月 4 日-2026 年 8 月 12 日。

（七）发行费用

单位：万元

项目	金额
承销保荐费用	950.00
律师费用	68.00
审计费用	93.00
资信评级费用	24.53
信息披露及发行手续等费用	15.33
合计	1,150.86

注：①以上金额均为不含税金额；②各项费用根据发行结果可能会有调整；③若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（八）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次发行的主要日程安排如下表所示：

日期	交易日	发行安排
2026 年 8 月 4 日 星期二	T-2 日	披露募集说明书及摘要、《发行公告》《网上路演公告》
2026 年 8 月 5 日 星期三	T-1 日	网上路演 原股东优先配售股权登记日
2026 年 8 月 6 日 星期四	T 日	披露《可转债发行提示性公告》 原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金）

日期	交易日	发行安排
		确定网上申购摇号中签率
2026年8月7日 星期五	T+1日	披露《网上中签率及优先配售结果公告》 根据中签率进行网上申购的摇号抽签
2026年8月10日 星期一	T+2日	披露《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 (投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)
2026年8月11日 星期二	T+3日	保荐人(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2026年8月12日 星期三	T+4日	披露《发行结果公告》

以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,公司将及时公告并修改发行日程。申请上市的证券交易所为上海证券交易所。

(九) 本次发行证券的上市流通

本次发行结束后,公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市,具体上市时间公司将另行公告。

(十) 本次发行可转债规模合理性分析

截至募集说明书签署日,公司不存在任何形式的公司债券。截至2026年3月31日,发行人净资产为166,984.60万元,本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过75,000.00万元。本次发行完成后,假设本次可转债转股期限内投资者均不选择转股,且不考虑可转债计入所有者权益部分的金额,预计发行人累计债券余额为75,000.00万元,占2026年3月末发行人净资产的比例为44.91%,未超过50%。2023年末、2024年末、2025年末和2026年3月末,公司资产负债率分别为30.54%、25.04%、24.57%和24.79%,具有合理的资产负债结构,不存在重大偿债风险。

2023年度、2024年度和2025年度,公司归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者计)分别为7,978.54万元、21,373.27万元和18,608.72万元,平均可分配利润为15,986.84万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金75,000.00万元计算,参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计,公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司

债券一年的利息。

综上，公司本次发行可转换公司债券的规模具有合理性。

(十一) 本次发行符合理性融资，合理确定融资规模

1、关于本次证券发行数量

本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 75,000.00 万元，发行数量为 750,000 手（7,500,000 张）。

2、关于融资间隔

上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。

前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。

公司本次发行可转债不适用上述规定，符合融资时间间隔的要求。

3、关于募集资金金额及投向

本次可转债募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目	30,401.55	28,750.00
2	半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目	26,470.57	25,050.00
3	半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	5,911.37	5,200.00
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		78,783.49	75,000.00

本次募集资金主要投向主业。本次募投项目“半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目”是公司对现有产能的扩充升级，旨在突破现有产能瓶颈，满

足下游客户持续增长的订单需求，同时通过建设高规格生产车间，满足半导体产业链升级迭代所带动的对设备零部件更高标准的生产环境和核心性能指标要求；本次募投项目“半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目”旨在通过开发陶瓷加热器填补国内缺口，同时突破公司现有业务领域，开辟全新增长曲线，优化公司产品与盈利结构，提升公司细分领域市场地位；本次募投项目“半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目”以公司在半导体设备零部件领域十余年的技术储备为基础，围绕半导体设备中重点关键产品静电吸盘（ESC）进行研发，攻克核心部件技术壁垒，进一步巩固公司技术领先优势。

综上，本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定。

三、本次发行可转债的基本条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行规模

本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 75,000.00 万元，发行数量为 750,000 手（7,500,000 张）。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转

换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息，计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026年8月12日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2027年2月12日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2032年8月5日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 86.40 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（九）转股价格的调整

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转

换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面金额及其所对应的当期应计利息。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十三) 回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 **70%**时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在满足附加回售条件后，可以在公司公告的回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十四) 转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配, 享有同等权益。

(十五) 发行方式及发行对象

1、发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2026年8月5日, T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行, 余额由保荐人(主承销商)包销。

2、发行对象

(1) 向发行人原股东优先配售: 发行公告公布的股权登记日(2026年8月5日, T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。

(2) 网上发行: 持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。

(3) 本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

(十六) 向现有股东配售的安排

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2026年8月5日, T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售。发行人现有总股本202,379,856股, 无回购专户库存股, 全部可参与原股东优先配售。若至股权

登记日（2026年8月5日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2026年8月6日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。

1、优先配售数量

原股东可优先配售的先锋转债数量为其在股权登记日（2026年8月5日，T-1日）收市后登记在册的持有先锋精科的股份数量按每股配售3.705元面值可转换公司债券的比例计算可配售的可转换公司债券金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.003705手可转换公司债券。

原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

发行人现有总股本202,379,856股，无回购专户库存股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为750,000手。

2、原股东的优先认购方法

（1）原股东优先配售的重要日期

股权登记日：2026年8月5日（T-1日）。

原股东优先配售认购及缴款日：2026年8月6日（T日）在上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00进行，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（2）原股东的优先认购方式

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为2026年8月6日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726605”，配售简称为

“先锋配债”。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配先锋转债，请投资者仔细查看证券账户内“先锋配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。

原股东持有的“先锋精科”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

（3）原股东的优先认购程序

①原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“先锋配债”的可配余额。

②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。

③原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验原股东交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

④原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

⑤原股东的委托一经接受，不得撤单。

3、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

（十七）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利和义务

（1）债券持有人的权利

- ①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- ②根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
- ③根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
- ⑤依照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定及《募集说明书》的相关约定享有其作为债券持有人的信息知情权；
- ⑥按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

- ①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
- ②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- ④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
- ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人

承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债的存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持有人会议：

- （1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
- （2）拟修改可转债持有人会议规则；
- （3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- （4）公司不能按期支付本次可转债本息；

（5）公司发生减资（因实施员工持股计划或股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

- （6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

（8）债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开；

（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

- （10）公司提出债务重组方案的；

- （11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（12）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：

- （1）公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人；

(3) 债券受托管理人；

(4) 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

(十八) 本次募集资金用途及实施方式

本次可转债募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目	30,401.55	28,750.00
2	半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目	26,470.57	25,050.00
3	半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	5,911.37	5,200.00
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		78,783.49	75,000.00

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

(十九) 募集资金管理及存放账户

公司已建立募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。

(二十) 担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十一）评级事项

公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，先锋精科主体信用级别为 **AAst**，本次可转换公司债券信用级别为 **AA**，评级展望为稳定。

本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。

（二十二）本次发行方案的有效期

本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为 12 个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

四、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称	江苏先锋精密科技股份有限公司
法定代表人	游利
住所	江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号
董事会秘书	XIE MEI
联系电话	0523-85110266

（二）保荐人（主承销商）

名称	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	江禹
住所	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
保荐代表人	刘天宇、金鸣
项目协办人	李雨滋
项目组成员	朱辉、吴学孔
联系电话	010-56839300
传真号码	010-56839300

（三）律师事务所

名称	上海市锦天城律师事务所
机构负责人	沈国权

住所	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12
经办律师	阙莉娜、李珊珊
联系电话	021-20511000
传真号码	021-20511999

（四）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	杨志国
住所	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
经办注册会计师	赵勇、胡国仁、王伟青、杨天航
联系电话	021-23280000
传真号码	021-63392558

（五）申请上市证券交易所

名称	上海证券交易所
住所	上海市浦东新区浦东南路 528 号
联系电话	021-68808888
传真号码	021-68804868

（六）收款银行

名称	中国工商银行深圳振华支行
开户名称	华泰联合证券有限责任公司
账户号码	4000010209200006013

（七）资信评级机构

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人	张剑文
住所	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7008 阳光高尔夫大厦 1509
经办人员	刘惠琼、李爱文（已离职）
联系电话	0755-82872897
传真号码	0755-82872090

五、发行人与本次发行有关的中介机构的关系

截至 2026 年 3 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的先锋

精科前 200 名股东的查询结果，除保荐人母公司控制的华泰创新投资有限公司依据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的要求实施跟投持有发行人 2,529,750 股，占发行人总股本的 1.25%外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第三节 发行人基本情况

一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司的股本总额为 202,379,856 股，其中前十大股东持股情况如下：

单位：股、%

股东名称	股份性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
游利	境内自然人	32,424,341	16.02	32,424,341
优立佳合伙	其他	20,571,132	10.16	-
英瑞启	境内非国有法人	18,744,694	9.26	18,744,694
优正合伙	其他	15,692,823	7.75	15,692,823
李欢	境内自然人	11,589,973	5.73	11,589,973
XU ZIMING	境外自然人	8,121,706	4.01	8,121,706
聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品等	5,504,671	2.72	-
优合合伙	其他	4,924,839	2.43	4,924,839
中微半导体设备（上海）股份有限公司	境内非国有法人	2,927,036	1.45	-
北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）	基金、理财产品等	2,608,882	1.29	-
合计		123,110,097	60.83	91,498,376

2026 年 6 月 17 日，公司收到优立佳合伙出具的《关于权益变动触及 5% 刻度的告知函》，优立佳合伙于 2026 年 6 月 17 日通过集中竞价交易的方式减持公司股份 333,146 股，其持有公司股份由 20,571,132 股减少至 20,237,986 股，占公司总股本的比例由 10.16%降至 10.00%。

二、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况

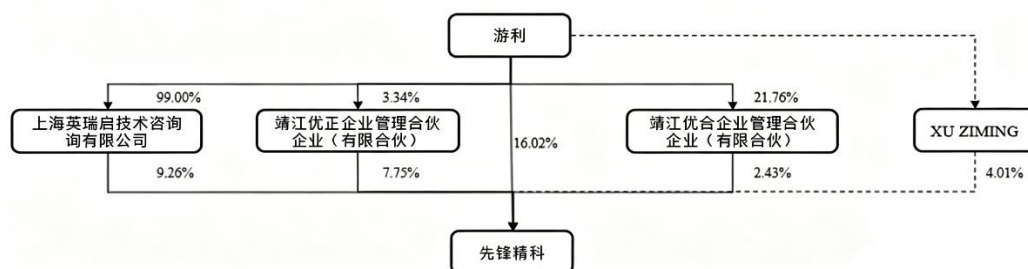
（一）控股股东和实际控制人

1、控股股东、实际控制人基本情况

截至 2026 年 3 月 31 日，游利直接持有公司 32,424,341 股股份，占本次发行前公司总股本的 16.02%。此外，游利通过英瑞启控制公司 9.26% 股份的

表决权，通过优正合伙控制公司 7.75% 股份的表决权，通过优合合伙控制公司 2.43% 股份的表决权，通过与 XU ZIMING 签署的《一致行动协议》控制公司 4.01% 股份的表决权。综上，游利合计控制公司 39.47% 股份的表决权，为公司控股股东、实际控制人。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司的控制结构图如下：



注：游利与 XU ZIMING 已签订《一致行动协议》

游利先生，董事长，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1988 年 9 月至 1994 年 5 月，担任中国空气动力研究与发展中心工程师；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，自由职业；1997 年 4 月至 1997 年 10 月，担任 UMS Group 工程师；1997 年 11 月至 2001 年 11 月，担任新加坡宇航制造公司工程师；2001 年 12 月至 2004 年 7 月，担任美西航空制造（苏州）有限公司工程部经理；2004 年 8 月至 2008 年 3 月，担任普美航空制造（苏州）有限公司制造部总监；2008 年 3 月至今，担任公司总经理；2017 年 5 月至 2021 年 11 月，担任公司执行董事；2021 年 12 月至今，担任公司董事长。2019 年 5 月至 2023 年 8 月，担任靖江先捷总经理，2019 年 5 月至今担任靖江先捷执行董事。2021 年 2 月至今，担任无锡先研执行董事；2021 年 9 月至今，担任先锋精密（新加坡）董事；2025 年 3 月至今，担任无锡至辰董事、经理。

公司 2024 年 12 月 12 日于上交所科创板上市。自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）控股股东及实际控制人所持股份被质押的情况

截至 2026 年 3 月 31 日，控股股东、实际控制人所持发行人股份不存在质押或冻结的情况。

（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业

除发行人及其子公司外，控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：

序号	企业名称	控制方式	主营业务
1	英瑞启	游利及其配偶褚潋持有 100%的股权	无实际生产经营
2	优正合伙	游利担任执行事务合伙人	发行人员工持股平台
3	优合合伙	游利担任执行事务合伙人	发行人员工持股平台

第四节 财务会计信息与管理层分析

公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时，综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额比重情况。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细的财务资料。

一、审计意见

发行人 2023 年度、2024 年度和 2025 年度财务报告已经立信会计师审计，并分别出具了信会师报字[2024]第 ZA13463 号、信会师报字[2025]第 ZA11991 号、信会师报字[2026]第 ZA10917 号标准无保留意见审计报告，2026 年 1-3 月财务报表未经审计。

除特别说明以外，本节分析的内容以公司经审计的三年年度合并财务报表及未经审计的 2026 年 1-3 月财务报表为基础。

以下财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动资产：				
货币资金	482,307,365.68	662,276,542.21	750,584,577.01	281,920,429.24
应收票据	33,929,571.32	54,070,149.84	30,749,830.38	3,346,573.55
应收账款	478,115,743.90	424,129,647.76	385,962,055.51	226,165,788.66
应收款项融资	61,901,866.15	31,551,503.20	70,742,812.08	25,741,632.78
预付款项	5,626,423.12	5,239,368.79	3,491,645.92	1,970,892.40

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
其他应收款	2,757,508.36	1,441,117.22	1,260,077.07	1,159,612.22
存货	347,790,920.22	305,543,868.74	266,376,338.39	176,642,236.66
其他流动资产	25,902,649.50	21,931,105.82	10,853,195.37	9,084,905.85
流动资产合计	1,438,332,048.25	1,506,183,303.58	1,520,020,531.73	726,032,071.36
非流动资产:				
固定资产	495,097,273.77	435,554,014.98	303,913,787.70	252,962,342.57
在建工程	167,803,252.11	145,236,217.66	61,492,399.29	15,400,570.08
使用权资产	2,587,062.95	3,703,227.83	7,595,213.70	3,724,784.77
无形资产	47,004,780.39	37,100,580.06	36,459,186.72	37,251,379.79
商誉	8,008,153.75	8,008,153.75	-	-
长期待摊费用	9,346,283.88	11,127,072.91	10,997,160.26	8,996,651.39
递延所得税资产	17,287,791.34	15,258,126.91	11,941,227.86	11,169,608.79
其他非流动资产	34,736,871.29	16,419,794.50	25,114,884.06	15,008,784.71
非流动资产合计	781,871,469.48	672,407,188.60	457,513,859.59	344,514,122.10
资产总计	2,220,203,517.73	2,178,590,492.18	1,977,534,391.32	1,070,546,193.46
流动负债:				
短期借款	39,023,750.00	39,023,750.00	39,026,833.33	30,026,250.00
应付票据	-	-	-	40,000,000.00
应付账款	332,927,772.34	341,632,788.11	354,756,239.66	203,739,462.56
合同负债	1,317,274.55	419,867.80	325,383.98	169,924.32
应付职工薪酬	14,103,358.80	17,517,934.70	24,334,984.52	9,639,656.18
应交税费	10,829,452.38	19,149,625.87	6,100,618.68	6,383,022.78
其他应付款	1,006,044.69	1,151,118.39	6,713,149.80	156,273.63
一年内到期的非流动负债	11,782,293.48	2,920,951.30	4,069,185.17	1,324,379.98
其他流动负债	31,302,657.84	21,663,231.16	29,813,503.12	1,422,090.16
流动负债合计	442,292,604.08	443,479,267.33	465,139,898.26	292,861,059.61
非流动负债:				
长期借款	82,116,753.43	67,752,123.37	-	-
租赁负债	647,884.82	677,733.95	3,767,688.58	2,552,776.70
递延收益	25,276,706.83	23,383,951.56	26,168,852.50	29,498,069.05
递延所得税负债	23,579.91	29,448.29	-	2,041,177.68
非流动负债合计	108,064,924.99	91,843,257.17	29,936,541.08	34,092,023.43

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
负债合计	550,357,529.07	535,322,524.50	495,076,439.34	326,953,083.04
所有者权益：				
股本	202,379,856.00	202,379,856.00	202,379,856.00	151,784,856.00
资本公积	955,474,612.69	953,668,384.14	941,278,166.14	466,954,511.22
盈余公积	53,926,387.65	53,926,387.65	36,077,730.24	14,760,000.89
未分配利润	458,065,132.32	433,293,339.89	302,722,199.60	110,093,742.31
归属于母公司所有者权益合计	1,669,845,988.66	1,643,267,967.68	1,482,457,951.98	743,593,110.42
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	1,669,845,988.66	1,643,267,967.68	1,482,457,951.98	743,593,110.42
负债和所有者权益总计	2,220,203,517.73	2,178,590,492.18	1,977,534,391.32	1,070,546,193.46

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	283,585,024.29	1,237,727,647.77	1,135,774,130.09	557,716,937.80
其中：营业收入	283,585,024.29	1,237,727,647.77	1,135,774,130.09	557,716,937.80
二、营业总成本	245,098,482.06	1,016,747,770.46	877,110,331.03	468,778,712.46
其中：营业成本	210,674,814.87	878,480,076.79	751,522,526.11	390,768,507.94
税金及附加	1,113,394.41	8,313,170.40	7,198,594.70	4,582,012.79
销售费用	2,239,529.36	5,796,747.90	6,641,727.47	5,019,640.01
管理费用	13,331,675.22	53,950,426.69	48,716,325.93	36,297,852.44
研发费用	15,979,602.58	71,377,055.49	64,083,194.59	36,308,998.87
财务费用	1,759,465.62	-1,169,706.81	-1,052,037.77	-4,198,299.59
其中：利息费用	801,406.79	3,501,874.52	2,184,085.50	1,700,251.65
利息收入	1,259,410.18	5,789,940.53	1,757,146.28	2,274,949.91
加：其他收益	1,099,529.06	10,118,653.40	8,998,415.73	6,802,626.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,682,743.60	-1,858,580.29	-9,653,787.88	-4,126,267.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,191,147.61	-11,983,872.43	-9,450,486.06	-1,565,000.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,194.47	200,371.34	-385,569.33	10,205.80

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,640,985.61	217,456,449.33	248,172,371.52	90,059,789.25
加：营业外收入	1,000.01	588.08	5,000.00	-
减：营业外支出	33,703.99	32,214.09	350,932.23	628,633.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,608,281.63	217,424,823.32	247,826,439.29	89,431,155.44
减：所得税费用	2,836,489.20	28,529,054.42	33,880,252.65	9,156,201.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,771,792.43	188,895,768.90	213,946,186.64	80,274,953.69
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,771,792.43	188,895,768.90	213,946,186.64	80,274,953.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润	24,771,792.43	188,895,768.90	213,946,186.64	80,274,953.69
2.少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	24,771,792.43	188,895,768.90	213,946,186.64	80,274,953.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,771,792.43	188,895,768.90	213,946,186.64	80,274,953.69
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.93	1.38	0.53
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.93	1.38	0.53

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	166,228,183.66	911,862,437.05	804,532,272.01	474,435,612.65
收到的税费返还	2,130,986.88	2,490,857.90	1,439,111.54	639,275.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,100,391.20	9,109,011.29	54,034,828.71	72,432,786.43
经营活动现金流入小计	172,459,561.74	923,462,306.24	860,006,212.26	547,507,674.66
购买商品、接受劳务支付的现金	120,959,828.12	346,743,336.69	421,310,057.81	200,022,489.05
支付给职工以及为职工支付的现金	70,319,342.56	246,442,677.61	173,369,307.70	101,111,925.16
支付的各项税费	17,227,757.70	69,932,227.18	79,942,542.48	23,386,965.08
支付其他与经营活动有关的现金	16,365,628.23	63,405,742.94	80,541,558.44	86,912,322.14
经营活动现金流出小计	224,872,556.61	726,523,984.42	755,163,466.43	411,433,701.43
经营活动产生的现金流量净额	-52,412,994.87	196,938,321.82	104,842,745.83	136,073,973.23
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,539.82	1,176,000.00	1,562,600.00	139,398.06
收到其他与投资活动有关的现金	-	16,400,000.00	16,400,000.00	5,600,000.00
投资活动现金流入小计	3,539.82	17,576,000.00	17,962,600.00	5,739,398.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,074,779.51	276,871,753.48	132,971,515.13	91,478,007.16
投资支付的现金	-	-	-	10.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	11,237,418.89	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	16,400,000.00	16,400,000.00	5,600,000.00
投资活动现金流出小计	148,074,779.51	304,509,172.37	149,371,515.13	97,078,017.21
投资活动产生的现金流量净额	-148,071,239.69	-286,933,172.37	-131,408,915.13	-91,338,619.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	536,944,497.00	-
其中：子公司吸收少数	-	-	-	-

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	23,976,980.00	106,752,123.37	39,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	411,579.28	291,050.00	-
筹资活动现金流入小计	23,976,980.00	107,163,702.65	576,235,547.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	44,950,000.00	30,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,369.11	44,594,533.45	1,882,503.65	1,511,257.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	905,439.67	15,175,993.84	20,390,072.82	2,374,428.97
筹资活动现金流出小计	1,649,808.78	104,720,527.29	52,272,576.47	52,885,686.31
筹资活动产生的现金流量净额	22,327,171.22	2,443,175.36	523,962,970.53	-17,885,686.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,812,113.19	-756,359.62	1,267,346.54	4,260,750.53
五、现金及现金等价物净增加额	-179,969,176.53	-88,308,034.80	498,664,147.77	31,110,418.30
加：期初现金及现金等价物余额	662,276,542.21	750,584,577.01	251,920,429.24	220,810,010.94
六、期末现金及现金等价物余额	482,307,365.68	662,276,542.21	750,584,577.01	251,920,429.24

三、发行人合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

发行人财务报表以持续经营假设为编制基础，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

（二）合并财务报表范围

截至 2026 年 3 月 31 日，发行人财务报表合并范围的子公司情况如下：

序号	子公司名称	层级	注册资本	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
1	靖江先捷	一级	10,000.00 万元	100.00	-	设立

序号	子公司名称	层级	注册资本	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
2	无锡先研	一级	11,000.00 万元	100.00	-	设立
3	先锋精密（新加坡）	一级	3 万新加坡元	100.00	-	设立
4	无锡至辰	二级	600.00 万元	-	100.00	收购

（三）报告期合并财务报表范围的变化

报告期内，公司合并报表范围变动情况如下：

1、非同一控制下企业合并

单位：%

被购买方名称	购买日	股权取得比例	股权取得方式
无锡至辰	2025 年 3 月	100.00	收购

2、注销孙公司

单位：%

子/孙公司名称	注销时间	持股比例
ULYC（新加坡）	2023 年 4 月	100.00

四、主要财务指标

（一）主要财务指标

主要财务指标	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率（倍）	3.25	3.40	3.27	2.48
速动比率（倍）	2.47	2.71	2.70	1.88
资产负债率（母公司）（%）	19.71	19.14	21.71	28.14
资产负债率（合并口径）（%）	24.79	24.57	25.04	30.54
主要财务指标	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次）	2.38	2.89	3.51	2.86
存货周转率（次）	2.35	2.81	3.08	2.01
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.26	0.97	0.52	0.90
每股净现金流量（元）	-0.89	-0.44	2.46	0.20
研发投入占营业收入的比例（%）	5.63	5.77	5.64	6.51

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产－存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2026 年一季度数据已作简单年化；

存货周转率=营业成本/存货平均余额，2026 年一季度数据已作简单年化；

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入。

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及每股收益计算如下：

项目	报告期间	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2026 年 1-3 月	1.50	0.12	0.12
	2025 年度	12.15	0.93	0.93
	2024 年度	24.97	1.38	1.38
	2023 年度	11.55	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2026 年 1-3 月	1.50	0.12	0.12
	2025 年度	11.97	0.92	0.92
	2024 年度	24.94	1.38	1.38
	2023 年度	11.48	0.53	0.53

（三）非经常性损益明细表

公司按照中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》编制了最近三年的非经常性损益表，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7.70	19.53	-61.57	-40.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-	313.27	99.69	123.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	-	-	-

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.69	-2.65	-11.58	-21.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小计	10.39	330.15	26.54	61.33
减：所得税影响额	-1.13	49.29	5.20	12.37
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-	-
合计	-9.26	280.86	21.35	48.96

五、会计政策变更和会计估计变更

（一）会计政策变更情况

1、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，

允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 会计估计变更情况

发行人报告期内无重要会计估计变更情况。

(三) 会计差错更正情况

发行人报告期内无会计差错更正情况。

六、财务状况分析

(一) 资产分析

报告期各期末，发行人资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	143,833.20	64.78	150,618.33	69.14	152,002.05	76.86	72,603.21	67.82
非流动资产	78,187.15	35.22	67,240.72	30.86	45,751.39	23.14	34,451.41	32.18
合计	222,020.35	100.00	217,859.05	100.00	197,753.44	100.00	107,054.62	100.00

报告期各期末，发行人资产总额分别为 107,054.62 万元、197,753.44 万元、217,859.05 万元和 222,020.35 万元。随着业务规模的扩大，发行人资产规模整体呈增长态势。

资产构成方面，报告期内公司流动资产占比较高，整体资产流动性良好。2024 年末，公司资产总额较年初增加 90,698.82 万元，流动资产占比上升，主要原因系当期期末公司收到首次公开发行募集资金；2025 年末资产总额较年初增加 20,105.61 万元，主要系当年未分配利润、盈余公积等留存收益增加，同时长期借款增加所致。

1、流动资产分析

报告期各期末，发行人流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	48,230.74	33.53	66,227.65	43.97	75,058.46	49.38	28,192.04	38.83
应收票据	3,392.96	2.36	5,407.01	3.59	3,074.98	2.02	334.66	0.46
应收账款	47,811.57	33.24	42,412.96	28.16	38,596.21	25.39	22,616.58	31.15
应收款项融资	6,190.19	4.30	3,155.15	2.09	7,074.28	4.65	2,574.16	3.55
预付款项	562.64	0.39	523.94	0.35	349.16	0.23	197.09	0.27
其他应收款	275.75	0.19	144.11	0.10	126.01	0.08	115.96	0.16
存货	34,779.09	24.18	30,554.39	20.29	26,637.63	17.52	17,664.22	24.33
其他流动资产	2,590.26	1.80	2,193.11	1.46	1,085.32	0.71	908.49	1.25
流动资产合计	143,833.20	100.00	150,618.33	100.00	152,002.05	100.00	72,603.21	100.00

报告期各期末，公司流动资产账面金额分别为 72,603.21 万元、152,002.05 万元、150,618.33 万元和 143,833.20 万元，占各期末总资产比例分别为 67.82%、76.86%、69.14%和 64.78%，整体资产流动性良好。

发行人流动资产主要由货币资金、应收票据与应收款项融资、应收账款、存货等构成，具体分析如下：

（1）货币资金

报告期各期末，发行人货币资金构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	0.68	0.001	3.46	0.01	3.68	0.00	0.72	0.00
银行存款	48,230.06	100.00	66,224.19	99.99	75,054.77	100.00	25,191.33	89.36
其他货币资金	-	-	-	-	-	-	3,000.00	10.64
合计	48,230.74	100.00	66,227.65	100.00	75,058.46	100.00	28,192.04	100.00
其中：存放在境外的款项总额	1,059.18	2.20	1,079.27	1.63	1,052.74	1.40	1,064.09	3.77

报告期各期末，发行人货币资金余额分别为 28,192.04 万元、75,058.46

万元、66,227.65 万元和 48,230.74 万元，占流动资产比例分别为 38.83%、49.38%、43.97%和 33.53%。报告期各期末，发行人货币资金主要为银行存款，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。2024 年末，发行人货币资金较 2023 年末增加较多，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。随着募集资金有序投入使用，2025 年末、2026 年 3 月末，发行人货币资金余额有所下降。

（2）应收票据与应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资均由银行承兑汇票构成，具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收票据	3,392.96	35.41	5,407.01	63.15	3,074.98	30.30	334.66	11.50
应收款项融资	6,190.19	64.59	3,155.15	36.85	7,074.28	69.70	2,574.16	88.50
合计	9,583.14	100.00	8,562.17	100.00	10,149.26	100.00	2,908.82	100.00

报告期各期末，发行人应收票据账面金额分别为 334.66 万元、3,074.98 万元、5,407.01 万元和 3,392.96 万元，占流动资产的比例分别为 0.46%、2.02%、3.59%和 2.36%，应收款项融资账面金额分别为 2,574.16 万元、7,074.28 万元、3,155.15 万元和 6,190.19 万元，占流动资产的比例分别为 3.55%、4.65%、2.09%和 4.30%。2024 年度，受益于下游半导体行业景气周期，发行人营业收入大幅增长，当期客户支付的票据规模相应增加，期末银行承兑汇票、已背书转让且未到期的应收票据余额上涨。

（3）应收账款

①应收账款变动情况

报告期各期末，发行人应收账款情况具体如下：

单位：万元、%

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收账款余额	50,468.88	44,810.52	40,796.20	23,868.59
坏账准备	2,657.31	2,397.55	2,200.00	1,252.01

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收账款账面价值	47,811.57	42,412.96	38,596.21	22,616.58
营业收入	28,358.50	123,772.76	113,577.41	55,771.69
应收账款账面价值占营业收入的比例	42.15	34.27	33.98	40.55

注：2026.3.31 应收账款账面余额占 2026 年 1-3 月营业收入比例已作简单年化处理

报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 22,616.58 万元、38,596.21 万元、42,412.96 万元和 47,811.57 万元，占流动资产的比例分别为 31.15%、25.39%、28.16% 和 33.24%，占当期营业收入的比例分别为 40.55%、33.98%、34.27% 和 42.15%。报告期内，发行人期末应收账款账面价值与当期营业收入基本匹配。

②应收账款账龄情况

报告期各期末，发行人应收账款账龄情况如下：

单位：万元、%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内 (含 1 年)	49,328.02	97.74	44,219.49	98.68	39,918.14	97.85	23,558.75	98.70
1-2 年	794.31	1.57	236.39	0.53	782.90	1.92	229.06	0.96
2-3 年	287.50	0.57	295.76	0.66	29.57	0.07	60.65	0.25
3-4 年	5.30	0.01	1.41	0.00	46.12	0.11	20.13	0.08
4-5 年	28.79	0.06	37.99	0.08	19.47	0.05	-	-
5 年以上	24.97	0.05	19.47	0.04	-	-	-	-
合计	50,468.88	100.00	44,810.52	100.00	40,796.20	100.00	23,868.59	100.00

报告期各期末，公司应收账款账龄绝大多数为 1 年以内，应收账款质量较好。

③坏账准备计提情况

报告期各期末，发行人应收账款坏账准备计提情况具体如下：

单位：万元、%

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

项目		2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
	坏账准备余额	-	-	-	-
	计提比例	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	应收账款余额	50,468.88	44,810.52	40,796.20	23,868.59
	坏账准备余额	2,657.31	2,397.55	2,200.00	1,252.01
	计提比例	5.27	5.35	5.39	5.25
合计	应收账款余额	50,468.88	44,810.52	40,796.20	23,868.59
	坏账准备余额	2,657.31	2,397.55	2,200.00	1,252.01
	计提比例	5.27	5.35	5.39	5.25

报告期各期末，公司无单项计提坏账准备的应收账款，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款均为账龄组合。

④应收账款余额前五大客户情况

报告期各期末，发行人应收账款余额前五大客户情况如下：

单位：万元、%

序号	单位名称	关系	应收账款余额	余额占比
2026.3.31				
1	北京北方华创微电子装备有限公司	非关联方	20,844.14	41.30
2	中微半导体（上海）有限公司	非关联方	5,250.04	10.40
3	成都超纯应用材料股份有限公司	非关联方	4,893.92	9.70
4	拓荆科技（上海）有限公司	非关联方	2,173.17	4.31
5	北京中硅泰克精密技术有限公司	非关联方	2,124.68	4.21
合计			35,285.95	69.92
2025.12.31				
1	北京北方华创微电子装备有限公司	非关联方	16,377.88	36.55
2	中微半导体（上海）有限公司	非关联方	4,931.26	11.00
3	成都超纯应用材料股份有限公司	非关联方	4,102.87	9.16
4	北京中硅泰克精密技术有限公司	非关联方	2,909.71	6.49
5	拓荆科技（上海）有限公司	非关联方	2,125.71	4.74
合计			30,447.42	67.95
2024.12.31				
1	北京北方华创微电子装备有限公司	非关联方	15,910.49	39.00

序号	单位名称	关系	应收账款余额	余额占比
2	中微半导体（上海）有限公司	非关联方	5,031.63	12.33
3	中微半导体设备（上海）股份有限公司	非关联方	2,911.90	7.14
4	拓荆科技（上海）有限公司	非关联方	2,501.86	6.13
5	北京中硅泰克精密技术有限公司	非关联方	1,767.45	4.33
合计			28,123.33	68.93
2023.12.31				
1	北京北方华创微电子装备有限公司	非关联方	6,650.49	27.86
2	江苏微导纳米科技股份有限公司	非关联方	2,530.67	10.60
3	中微半导体（上海）有限公司	非关联方	2,048.55	8.58
4	拓荆科技（上海）有限公司	非关联方	1,520.92	6.37
5	北京屹唐半导体科技股份有限公司	非关联方	957.10	4.01
合计			13,707.72	57.42

报告期各期末，发行人应收账款前五名客户与当期主要客户基本一致。

（4）存货

报告期各期末，发行人存货构成情况如下：

单位：万元、%

日期	项目	账面余额		跌价准备	账面价值
		金额	占比		
2026.3.31	原材料	4,038.24	10.57	484.69	3,553.55
	委托加工物资	4,025.36	10.54	240.82	3,784.54
	在制品	19,281.56	50.49	1,771.96	17,509.60
	库存商品	8,056.66	21.10	690.10	7,366.56
	发出商品	2,786.83	7.30	222.00	2,564.84
	合计	38,188.65	100.00	3,409.56	34,779.09
2025.12.31	原材料	2,786.56	8.31	475.02	2,311.54
	委托加工物资	2,844.15	8.48	182.77	2,661.38
	在制品	17,672.08	52.72	1,462.96	16,209.12
	库存商品	8,129.83	24.25	674.33	7,455.51
	发出商品	2,087.80	6.23	170.96	1,916.84
	合计	33,520.42	100.00	2,966.03	30,554.39
2024.12.31	原材料	2,458.25	8.47	282.60	2,175.64

日期	项目	账面余额		跌价准备	账面价值
		金额	占比		
	委托加工物资	2,968.95	10.22	231.87	2,737.08
	在制品	13,909.95	47.90	1,137.31	12,772.64
	库存商品	6,913.36	23.81	568.77	6,344.59
	发出商品	2,787.57	9.60	179.89	2,607.68
	合计	29,038.07	100.00	2,400.44	26,637.63
2023.12.31	原材料	1,890.31	9.57	310.96	1,579.36
	委托加工物资	2,205.19	11.16	220.45	1,984.74
	在制品	9,214.05	46.65	878.37	8,335.68
	库存商品	3,824.12	19.36	495.91	3,328.21
	发出商品	2,619.70	13.26	183.47	2,436.23
	合计	19,753.38	100.00	2,089.15	17,664.22

报告期各期末，发行人存货余额分别为 19,753.38 万元、29,038.07 万元、33,520.42 万元和 38,188.65 万元，账面价值分别为 17,664.22 万元、26,637.63 万元、30,554.39 万元和 34,779.09 万元，占流动资产的比例分别为 24.33%、17.52%、20.29%和 24.18%。发行人存货主要由在制品、库存商品、发出商品、委托加工物资、原材料等构成，各期末存货结构整体较为稳定。2024 年末，发行人存货余额大幅上升，主要原因系当期发行人收入显著增长，为保障订单及时交付，公司相应增加备货。2026 年 3 月，随着下游需求回暖，发行人备库增多，期末各类存货余额提高。

2、非流动资产分析

报告期各期末，发行人非流动资产构成具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	49,509.73	63.32	43,555.40	64.78	30,391.38	66.43	25,296.23	73.43
在建工程	16,780.33	21.46	14,523.62	21.60	6,149.24	13.44	1,540.06	4.47
使用权资产	258.71	0.33	370.32	0.55	759.52	1.66	372.48	1.08
无形资	4,700.48	6.01	3,710.06	5.52	3,645.92	7.97	3,725.14	10.81

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产								
商誉	800.82	1.02	800.82	1.19	-	-	-	-
长期待摊费用	934.63	1.20	1,112.71	1.65	1,099.72	2.40	899.67	2.61
递延所得税资产	1,728.78	2.21	1,525.81	2.27	1,194.12	2.61	1,116.96	3.24
其他非流动资产	3,473.69	4.44	1,641.98	2.44	2,511.49	5.49	1,500.88	4.36
非流动资产合计	78,187.15	100.00	67,240.72	100.00	45,751.39	100.00	34,451.41	100.00

报告期各期末，发行人非流动资产分别为 34,451.41 万元、45,751.39 万元、67,240.72 万元和 78,187.15 万元，随公司生产经营规模的扩大而逐年增加，占资产总额比例分别为 32.18%、23.14%、30.86%和 35.22%。发行人的非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产构成，报告期各期末，三项资产合计金额分别为 30,561.43 万元、40,186.54 万元、61,789.08 万元和 70,990.53 万元，占非流动资产的比例分别为 88.71%、87.84%、91.89%和 90.80%。

2025 年 3 月，公司收购无锡至辰，形成商誉 800.82 万元，截至报告期末，相关资产组经营状况良好，商誉不存在减值迹象。

（1）固定资产

报告期各期末，发行人固定资产情况如下所示：

单位：万元、%

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	账面价值占比
2026.3.31					
房屋及建筑物	17,321.03	2,209.04	-	15,111.99	30.52
机器设备	36,752.64	9,956.33	-	26,796.31	54.12
运输设备	489.16	344.08	-	145.09	0.29
电子设备	853.58	473.89	-	379.69	0.77
其他设备	11,556.50	4,479.85	-	7,076.65	14.29

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	账面价值占比
合计	66,972.92	17,463.19	-	49,509.73	100.00
2025.12.31					
房屋及建筑物	17,056.30	2,005.41	-	15,050.89	34.56
机器设备	31,523.36	9,186.27	-	22,337.09	51.28
运输设备	489.16	324.95	-	164.21	0.38
电子设备	827.58	426.76	-	400.82	0.92
其他设备	9,781.96	4,179.57	-	5,602.39	12.86
合计	59,678.37	16,122.97	-	43,555.40	100.00
2024.12.31					
房屋及建筑物	9,355.06	1,417.95	-	7,937.11	26.12
机器设备	23,598.22	6,503.32	-	17,094.90	56.25
运输设备	400.05	234.60	-	165.45	0.54
电子设备	540.48	279.67	-	260.80	0.86
其他设备	8,004.84	3,071.73	-	4,933.10	16.23
合计	41,898.65	11,507.27	-	30,391.38	100.00
2023.12.31					
房屋及建筑物	9,094.59	980.73	-	8,113.87	32.08
机器设备	17,672.19	4,986.73	-	12,685.46	50.15
运输设备	291.97	173.20	-	118.77	0.47
电子设备	286.21	207.88	-	78.34	0.31
其他设备	6,434.38	2,134.59	-	4,299.79	17.00
合计	33,779.36	8,483.12	-	25,296.23	100.00

报告期各期末，发行人固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备。报告期内，发行人固定资产原值持续增长，主要原因系：1）报告期内，为满足更高制程对半导体零部件日益严格的质量要求，发行人新建多间高标准洁净车间、购置大量机器设备；2）发行人首发募投项目等工程项目有序建设，随着厂房陆续完工转固，房屋及建筑物原值相应增加。

整体来看，发行人固定资产运行良好，能够按照预定用途发挥经济效益，不存在需要计提减值准备的情形。

(2) 在建工程

报告期各期末，发行人在建工程构成如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
无锡先研设备模组生产与装配基地项目	13,809.55	7,701.33	-	-
机器设备及车间改造	2,199.72	5,479.68	2,223.77	1,540.06
新港高新园区二期厂房	-	1,107.56	3,925.47	-
江苏先锋精密科技股份有限公司 6#、7#厂房建设项目	-	235.06	-	-
先锋精科半导体先进制程核心工艺器件研发制造项目	771.06	-	-	-
合计	16,780.33	14,523.62	6,149.24	1,540.06

报告期各期末，发行人在建工程金额分别为 1,540.06 万元、6,149.24 万元、14,523.62 万元和 16,780.33 万元，逐年上升。

2024 年末，公司在建工程账面价值较 2023 年末增加 4,609.18 万元，主要原因系发行人新港高新园区二期厂房开工建设。2025 年末，公司在建工程账面价值较 2024 年末增加 8,374.38 万元，主要原因系：1) 发行人稳步推进募投项目建设，期末无锡先研设备模组生产与装配基地项目金额增加较多；2) 为提升产品工艺能力，发行人当期投入机器设备及车间改造金额较多。

(3) 无形资产

报告期各期末，发行人无形资产构成如下：

单位：万元、%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地使用权	4,436.44	94.38	3,423.99	92.29	3,499.89	95.99	3,575.78	95.99
软件使用权	190.16	4.05	206.39	5.56	146.03	4.01	149.36	4.01
专利权	6.72	0.14	8.79	0.24	-	-	-	-
排污权交易费	67.15	1.43	70.88	1.91	-	-	-	-
合计	4,700.48	100.00	3,710.06	100.00	3,645.92	100.00	3,725.14	100.00

报告期各期末，发行人无形资产金额分别为 3,725.14 万元、3,645.92 万元、3,710.06 万元和 4,700.48 万元，主要为土地使用权、软件使用权。

（二）负债分析

报告期各期末，发行人负债结构如下表所示：

单位：万元、%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	44,229.26	80.36	44,347.93	82.84	46,513.99	93.95	29,286.11	89.57
非流动负债	10,806.49	19.64	9,184.33	17.16	2,993.65	6.05	3,409.20	10.43
负债总额	55,035.75	100.00	53,532.25	100.00	49,507.64	100.00	32,695.31	100.00

报告期各期末，发行人负债总额分别为 32,695.31 万元、49,507.64 万元、53,532.25 万元和 55,035.75 万元，流动负债占负债总额的比例分别为 89.57%、93.95%、82.84%和 80.36%，为公司负债的主要组成部分。

1、流动负债分析

报告期各期末，发行人的流动负债具体构成及占比情况如下：

单位：万元、%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	3,902.38	8.82	3,902.38	8.80	3,902.68	8.39	3,002.63	10.25
应付票据	-	-	-	-	-	-	4,000.00	13.66
应付账款	33,292.78	75.27	34,163.28	77.03	35,475.62	76.27	20,373.95	69.57
合同负债	131.73	0.30	41.99	0.09	32.54	0.07	16.99	0.06
应付职工薪酬	1,410.34	3.19	1,751.79	3.95	2,433.50	5.23	963.97	3.29
应交税费	1,082.95	2.45	1,914.96	4.32	610.06	1.31	638.30	2.18
其他应付款	100.60	0.23	115.11	0.26	671.31	1.44	15.63	0.05
一年内到期的非流动负债	1,178.23	2.66	292.10	0.66	406.92	0.87	132.44	0.45
其他流动负债	3,130.27	7.08	2,166.32	4.88	2,981.35	6.41	142.21	0.49
流动负债	44,229.26	100.00	44,347.93	100.00	46,513.99	100.00	29,286.11	100.00

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
债合计								

报告期各期末，发行人流动负债分别为 29,286.11 万元、46,513.99 万元、44,347.93 万元和 44,229.26 万元。2024 年末，发行人流动负债金额较 2023 年末大幅上升，主要原因系：受益于下游半导体行业景气周期，2024 年度发行人产销两旺，采购规模大幅增长，从而期末经营性应付金额较高。

报告期各期末，发行人流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、其他流动负债等构成，具体分析如下：

（1）短期借款

报告期各期末，发行人短期借款余额分别为 3,002.63 万元、3,902.68 万元、3,902.38 万元和 3,902.38 万元，占发行人流动负债比例分别为 10.25%、8.39%、8.80%和 8.82%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
保证借款	3,900.00	3,000.00	3,900.00	3,000.00
信用借款	-	900.00	-	-
应付利息	2.38	2.38	2.68	2.63
合计	3,902.38	3,902.38	3,902.68	3,002.63

报告期各期末，发行人短期借款余额较为稳定。

（2）应付票据和应付账款

报告期各期末，发行人应付票据和应付账款金额合计分别为 24,373.95 万元、35,475.62 万元、34,163.28 万元和 33,292.78 万元，占流动负债比例分别为 83.23%、76.27%、77.03%和 75.27%，是发行人流动负债的主要组成部分，主要为应付供应商材料款和应付工程设备款。报告期内，随着发行人业务规模扩大以及新厂房建设投资增加，材料采购、委外加工、设备购置和工程施工等增多，使得期末应付款项规模整体呈上升趋势。

报告期各期末，发行人应付账款前五大单位如下：

单位：万元、%

序号	单位名称	金额	占比	款项性质
2026.3.31				
1	靖江新恒和半导体科技有限公司	3,359.58	10.09	定制件和外协采购款
2	苏州市乐了精密机械制造厂	2,496.79	7.50	定制件和外协采购款
3	东贺隆（昆山）电子有限公司	1,869.38	5.61	外协采购款
4	无锡元基精密机械有限公司	1,339.59	4.02	定制件和外协采购款
5	优密铝业（苏州）有限公司	1,174.41	3.53	原材料采购款
合计		10,239.76	30.76	
2025.12.31				
1	靖江新恒和半导体科技有限公司	3,701.99	10.84	定制件和外协采购款
2	东贺隆（昆山）电子有限公司	2,810.57	8.23	外协采购款
3	江苏禹翔建设有限公司	2,560.08	7.49	工程款
4	苏州市乐了精密机械制造厂	1,814.96	5.31	定制件和外协采购款
5	无锡元基精密机械有限公司	1,595.12	4.67	定制件和外协采购款
合计		12,482.72	36.54	-
2024.12.31				
1	靖江新恒和半导体科技有限公司	4,658.20	13.13	定制件和外协采购款
2	江苏禹翔建设有限公司	3,838.04	10.82	工程款
3	苏州市乐了精密机械制造厂	3,691.02	10.40	定制件和外协采购款
4	东贺隆（昆山）电子有限公司	2,406.55	6.78	外协采购款
5	无锡元基精密机械有限公司	1,620.40	4.57	定制件和外协采购款
合计		16,214.21	45.71	-
2023.12.31				
1	靖江新恒和半导体科技有限公司	2,705.44	13.28	定制件和外协采购款
2	苏州市乐了精密机械制造厂	1,829.84	8.98	定制件和外协采购款
3	无锡元基精密机械有限公司	1,367.92	6.71	定制件和原材料采购款
4	苏州美德航空航天材料有限公司	1,017.21	4.99	原材料采购款
5	江苏广锋建筑工程有限公司	1,007.01	4.94	工程款
合计		7,927.42	38.91	-

(3) 应付职工薪酬

报告期各期末，发行人应付职工薪酬构成情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
一、短期薪酬	1,407.91	1,749.58	2,433.34	963.64
二、离职后福利—设定提存计划	1.91	1.69	0.15	0.33
三、辞退福利	0.52	0.52	-	-
合计	1,410.34	1,751.79	2,433.50	963.97

报告期各期末，发行人应付职工薪酬余额分别为 963.97 万元、2,433.50 万元、1,751.79 万元和 1,410.34 万元，占流动负债比例分别为 3.29%、5.23%、3.95%和 3.19%。应付职工薪酬主要为短期薪酬，由月度工资、季度奖金、年终奖等构成，其变动与公司职工人数、薪酬标准以及奖金计提相关。2024 年末应付职工薪酬余额较年初增长较多，主要由于公司人员数量随业务规模扩大而增加，且当年末计提奖金增加。

（4）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为 142.21 万元、2,981.35 万元、2,166.32 万元和 3,130.27 万元，占流动负债比例分别为 0.49%、6.41%、4.88%和 7.08%。其他流动负债明细如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
待转销项税额	17.06	12.82	4.23	2.21
票据背书未终止确认的负债	3,113.21	2,153.50	2,977.12	140.00
合计	3,130.27	2,166.32	2,981.35	142.21

公司其他流动负债主要为已背书未到期但不符合终止确认条件的银行承兑汇票。

2、非流动负债分析

报告期各期末，发行人非流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	8,211.68	75.99	6,775.21	73.77	-	-	-	-
租赁负债	64.79	0.60	67.77	0.74	376.77	12.59	255.28	7.49

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延收益	2,527.67	23.39	2,338.40	25.46	2,616.89	87.41	2,949.81	86.52
递延所得税负债	2.36	0.02	2.94	0.03	-	-	204.12	5.99
合计	10,806.49	100.00	9,184.33	100.00	2,993.65	100.00	3,409.20	100.00

报告期各期末，发行人非流动负债金额分别为 3,409.20 万元、2,993.65 万元、9,184.33 万元和 10,806.49 万元，主要由长期借款和递延收益组成。

（1）长期借款

2023 年末、2024 年末，发行人不存在长期借款。2025 年末，为满足靖江先捷项目建设及相关设备投资资金需求，发行人借入抵押借款。

（2）递延收益

发行人递延收益均为与资产相关的政府补助，报告期各期末金额分别为 2,949.81 万元、2,616.89 万元、2,338.40 万元和 2,527.67 万元，占非流动负债的比例分别为 86.52%、87.41%、25.46%和 23.39%，2023 年至 2025 年末，随着大额政府补助分期确认为其他收益，递延收益余额减少。2026 年 3 月末，公司递延收益有所增加，主要系当期收到人才攻关联合体年度资助费 250 万。

（三）偿债能力分析

1、发行人偿债能力指标

报告期内，发行人的主要偿债指标情况如下表所示：

单位：倍、%

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率	3.25	3.40	3.27	2.48
速动比率	2.47	2.71	2.70	1.88
资产负债率（合并）	24.79	24.57	25.04	30.54

报告期各期末，发行人流动比率分别为 2.48、3.27、3.40 和 3.25，速动比率分别为 1.88、2.70、2.71 和 2.47。报告期内发行人销售情况良好，回款正常，短期偿债能力指标处于正常水平，不存在显著的短期偿债风险。

报告期各期末，发行人资产负债率分别为 30.54%、25.04%、24.57%和 24.79%，资产负债率处于适中水平。2024 年末资产负债率下降，主要原因系当期公司首发募集资金到账。

2、与同行业上市公司相关指标对比分析

报告期内，公司与同行业可比上市公司主要偿债指标对比如下：

单位：倍、%

公司简称	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率				
富创精密	1.75	1.71	2.17	3.43
珂玛科技	2.49	2.48	3.04	1.74
托伦斯	未披露	1.91	2.61	2.23
可比公司平均值	2.12	2.03	2.61	2.47
先锋精科	3.25	3.40	3.27	2.48
速动比率				
富创精密	1.27	1.22	1.65	2.67
珂玛科技	1.83	1.85	2.41	1.28
托伦斯	未披露	1.60	2.22	1.78
可比公司平均值	1.55	1.56	2.09	1.91
先锋精科	2.47	2.71	2.70	1.88
合并资产负债率				
富创精密	48.87	48.59	43.77	37.29
珂玛科技	31.22	31.75	22.77	45.44
托伦斯	未披露	40.70	31.06	37.41
可比公司平均值	40.04	40.35	32.53	40.05
先锋精科	24.79	24.57	25.04	30.54

注：可比公司数据根据可比公司公开披露数据计算

整体而言，发行人的流动比率、速动比率高于可比公司，合并资产负债率略低于可比公司，主要与经营理念及上市时间有关。具体而言：1）发行人致力于建设持续稳定的精益生产管理体系，经营较为稳健，举债较为谨慎；2）2023 年末，公司流动比率、速动比率低于富创精密，主要原因系富创精密于 2022 年上市，首发募集资金到账后短期借款金额大幅降低；3）2024 年，公司流动比率、速动比率大幅上升，高于可比公司平均水平，主要原因系 2024 年

未发行人首发募集资金到账。

综上，公司的资产负债结构较为合理，偿债风险较低，后期随着业务规模的提升以及恰当的直接融资，公司的偿债能力将进一步提升。

（四）营运能力分析

1、发行人资产周转能力指标分析

报告期内，发行人资产周转能力有关财务指标如下：

单位：次

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率	2.38	2.89	3.51	2.86
存货周转率	2.35	2.81	3.08	2.01

注：

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2026 年一季度数据已作简单年化；

存货周转率=营业成本/存货平均余额，2026 年一季度数据已作简单年化；

报告期各期，发行人应收账款和存货周转总体情况良好。2024 年度，发行人应收账款周转率、存货周转率上升，主要原因系受益于下游半导体设备市场步入上行周期及国产化进程持续推进，当期发行人收入同比增长 103.65%，而期初应收账款、存货余额相对较低。2025 年度，公司收入、成本温和增长，应收账款周转率、存货周转率有所回落。2026 年一季度，公司应收账款周转率和存货周转率受经营淡季影响较低。

2、与同行业上市公司相关指标对比分析

报告期各期末，发行人应收账款周转率、存货周转率与同行业上市公司的比较情况如下：

单位：次

公司简称	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收账款周转率				
富创精密	2.78	2.72	2.98	3.00
珂玛科技	2.03	2.42	2.77	2.31
托伦斯	未披露	3.15	3.57	2.96
可比公司平均值	2.40	2.76	3.11	2.76
先锋精科	2.38	2.89	3.51	2.86
存货周转率				

公司简称	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
富创精密	2.93	2.51	2.32	2.04
珂玛科技	1.69	1.67	1.68	1.77
托伦斯	未披露	3.17	3.29	2.16
可比公司平均值	2.31	2.45	2.43	1.99
先锋精科	2.35	2.81	3.08	2.01

注 1：可比公司数据根据可比公司公开披露数据计算

注 2：受限于数据可得性，富创精密和珂玛科技 2026.3.31 数据根据其应收账款账面价值与存货账面价值计算，并已作简单年化

注 3：2026.3.31，发行人与可比公司同口径下的应收账款周转率简单年化后为 2.51，存货周转率简单年化后为 2.58

报告期内，发行人应收账款周转率、存货周转率略高于可比公司平均水平。2024 年度，下游半导体行业景气周期下，发行人与可比公司应收账款周转率、存货周转率变动趋势基本相同。

（五）公司最近一期末未持有金额较大的财务性投资

1、财务性投资的认定依据

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。”

根据中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条等相关规定，“财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。”

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他

从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。”

2、截至最近一期末公司财务性投资的情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司相关的会计科目情况如下：

单位：万元

序号	项目	账面价值	财务性投资金额
1	货币资金	48,230.74	-
2	其他应收款	275.75	-
3	其他流动资产	2,590.26	-
合计		51,096.75	-

(1) 货币资金

截至 2026 年 3 月 31 日，公司货币资金账面价值为 48,230.74 万元，全部为库存现金、银行存款，不属于财务性投资。

(2) 其他应收款

截至 2026 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 275.75 万元，主要为押金及保证金、备用金，不属于财务性投资。

(3) 其他流动资产

截至 2026 年 3 月 31 日，公司其他流动资产账面价值为 2,590.26 万元，全部为增值税留抵税额，不属于财务性投资。

3、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司已实施或拟实施的财务性投资情况

2026 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。自本次发行董事会决议日前六个月起至募集说明书签署日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资，具体情况如下：

(1) 类金融

自本次发行董事会决议日前六个月起至募集说明书签署日，公司不存在对融资租赁、商业保理和小额贷款业务等类金融业务投资情况。本次募集资金不存在直接或变相用于类金融业务的情形。

(2) 设立或投资产业基金、并购基金

自本次发行董事会决议日前六个月起至募集说明书签署日，公司不存在设立或投资产业基金、并购基金的情形。

(3) 拆借资金、委托贷款

自本次发行董事会决议日前六个月起至募集说明书签署日，公司不存在对外拆借资金、委托贷款的情形。

(4) 以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

自本次发行董事会决议日前六个月起至募集说明书签署日，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。

(5) 购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行董事会决议日前六个月起至募集说明书签署日，公司存在使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品的情形，上述产品不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

(6) 非金融企业投资金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月起至募集说明书签署日，公司不存在投资金融业务的情形。

(7) 实施或拟实施的财务性投资的具体情况

自本次发行董事会决议日前六个月起至募集说明书签署日，公司不存在拟实施财务性投资的相关安排。

七、经营成果分析

（一）营业收入分析

1、营业收入构成情况

报告期内，公司营业收入具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	28,158.95	99.30	123,024.01	99.40	112,781.62	99.30	55,002.93	98.62
其他业务	199.55	0.70	748.75	0.60	795.79	0.70	768.76	1.38
合计	28,358.50	100.00	123,772.76	100.00	113,577.41	100.00	55,771.69	100.00

报告期各期，发行人营业收入分别为 55,771.69 万元、113,577.41 万元、123,772.76 万元和 28,358.50 万元，2024 年度，受益于下游半导体设备市场步入上行周期及国产化进程持续推进，发行人营业收入增长 103.65%。

公司主营业务突出，报告期各期主营业务收入占营业收入的比重均超过 98%，具有良好的盈利能力和持续发展能力。公司其他业务收入主要为废料、长库龄原材料销售及技术服务等。

2、主营业务收入分产品分析

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工艺部件	20,369.51	72.34	89,409.33	72.68	81,906.26	72.62	37,079.81	67.41
结构部件	5,693.72	20.22	23,784.85	19.33	22,663.22	20.09	9,631.65	17.51
其他部件	742.68	2.64	3,450.90	2.81	3,139.64	2.78	6,434.93	11.70
模组	1,037.80	3.69	5,019.95	4.08	4,216.50	3.74	1,194.07	2.17
表面处理	315.24	1.12	1,358.99	1.10	855.99	0.76	662.47	1.20
合计	28,158.95	100.00	123,024.01	100.00	112,781.62	100.00	55,002.93	100.00

（1）工艺部件

报告期内，发行人工艺部件收入分别为 37,079.81 万元、81,906.26 万元、89,409.33 万元和 20,369.51 万元，占主营业务收入比例分别为 67.41%、

72.62%、72.68%和 72.34%。2024 年起，发行人工艺部件收入占比上升，主要系为应对半导体行业景气周期下旺盛需求，发行人产能向半导体零部件倾斜。

（2）结构部件

报告期内，发行人结构部件收入分别为 9,631.65 万元、22,663.22 万元、23,784.85 万元和 5,693.72 万元，占主营业务收入比例分别为 17.51%、20.09%、19.33%和 20.22%。2024 年度，发行人结构部件收入、收入占比上升。发行人结构部件主要为腔体提供配套，其收入变化趋势与工艺部件基本一致。

（3）其他部件

报告期内，发行人其他部件收入分别为 6,434.93 万元、3,139.64 万元、3,450.90 万元和 742.68 万元，占主营业务收入比例分别为 11.70%、2.78%、2.81%和 2.64%。2024 年度，发行人其他部件收入、收入占比下降，主要原因系下游半导体行业景气周期下，发行人向光伏部件分配的产能减少。

（4）模组

报告期内，发行人模组收入分别为 1,194.07 万元、4,216.50 万元、5,019.95 万元和 1,037.80 万元，占主营业务收入比例分别为 2.17%、3.74%、4.08%和 3.69%，随着发行人模组业务的逐渐成熟，整体呈上升趋势。

（5）表面处理

报告期内，发行人表面处理收入分别为 662.47 万元、855.99 万元、1,358.99 万元和 315.24 万元，占主营业务收入比例为 1.20%、0.76%、1.10%和 1.12%，占比较低。报告期内，发行人表面处理业务收入有所增长，主要原因系：1）公司新增多条表面处理产线，为半导体行业客户配套提供的表面处理服务增多；2）2025 年，先捷航空表面处理业务通过客户验证，航空零部件表面处理收入增加；3）2025 年一季度，公司收购了主营业务为表面处理涂层业务的无锡至辰。

3、主营业务收入分地区构成分析

报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国大陆地区	27,847.06	98.89	120,875.82	98.25	110,827.51	98.27	53,779.80	97.78
中国大陆以外	311.89	1.11	2,148.20	1.75	1,954.10	1.73	1,223.13	2.22
合计	28,158.95	100.00	123,024.01	100.00	112,781.62	100.00	55,002.93	100.00

报告期内，发行人主营业务收入主要来自中国大陆地区。公司树立了优先服务国内本土半导体设备企业的战略方针，深耕半导体产业链核心领域，筑牢国产半导体设备供应链安全基础，积极推动国内大循环。

4、主营业务收入的季节性变动

报告期内，公司各季度主营业务收入情况如下：

单位：万元、%

期间	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	28,158.95	100.00	29,804.56	24.23	21,441.48	19.01	9,599.10	17.45
第二季度	-	-	35,279.98	28.68	32,943.61	29.21	12,274.56	22.32
第三季度	-	-	31,182.19	25.35	31,905.12	28.29	14,938.69	27.16
第四季度	-	-	26,757.28	21.75	26,491.41	23.49	18,190.59	33.07
合计	28,158.95	100.00	123,024.01	100.00	112,781.62	100.00	55,002.93	100.00

报告期内，发行人主营业务收入不存在显著季节性特征，各季度收入变动主要受半导体行业周期性影响。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成情况

报告期内，公司营业成本具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	21,065.08	99.99	87,847.57	100.00	75,152.25	100.00	38,982.86	99.76

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他业务	2.40	0.01	0.43	0.00	-	-	93.99	0.24
合计	21,067.48	100.00	87,848.01	100.00	75,152.25	100.00	39,076.85	100.00

报告期内，公司营业成本主要为主营业务成本。发行人其他业务主要为销售生产过程中产生的废料，上述废料未归集成本。

2、主营业务成本构成情况

公司主营业务成本按产品分类情况如下表：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工艺部件	14,276.46	67.77	60,263.65	68.60	52,571.99	69.95	23,714.33	60.83
结构部件	4,821.21	22.89	18,914.32	21.53	15,438.52	20.54	7,267.51	18.64
其他部件	847.62	4.02	3,403.58	3.87	3,145.61	4.19	6,419.47	16.47
模组	901.35	4.28	4,188.77	4.77	3,490.80	4.64	1,152.83	2.96
表面处理	218.45	1.04	1,077.26	1.23	505.34	0.67	428.73	1.10
合计	21,065.08	100.00	87,847.57	100.00	75,152.25	100.00	38,982.86	100.00

报告期各期，公司工艺部件、结构部件、其他部件等各类零部件销售成本占主营业务成本的比例分别为 95.94%、94.68%、94.01%和 94.68%，系主营业务成本的主要构成部分。报告期内，公司的主营业务成本与主营业务收入构成基本一致，变动趋势相符。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利分析

报告期各期，公司毛利构成及变动情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	7,093.87	97.30	35,176.44	97.92	37,629.37	97.93	16,020.07	95.96
其他业务	197.15	2.70	748.32	2.08	795.79	2.07	674.77	4.04
合计	7,291.02	100.00	35,924.76	100.00	38,425.16	100.00	16,694.84	100.00

报告期各期，发行人毛利主要来自主营业务，主营业务突出，其他业务对公司综合毛利的贡献较小。

报告期各期，公司主营业务毛利情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工艺部件	6,093.06	85.89	29,145.68	82.86	29,334.28	77.96	13,365.48	83.43
结构部件	872.51	12.30	4,870.53	13.85	7,224.70	19.20	2,364.15	14.76
其他部件	-104.94	-1.48	47.32	0.13	-5.96	-0.02	15.46	0.10
模组	136.45	1.92	831.18	2.36	725.70	1.93	41.24	0.26
表面处理	96.79	1.36	281.73	0.80	350.65	0.93	233.74	1.46
合计	7,093.87	100.00	35,176.44	100.00	37,629.37	100.00	16,020.07	100.00

报告期各期，公司工艺部件、结构部件等半导体设备零部件贡献了主营业务毛利的 98.19%、97.16%、96.70%和 98.19%，系主营业务毛利的主要源泉。

2、主营业务毛利率分析

报告期内公司主营业务各类产品的毛利率及占主营业务收入的比重如下：

单位：%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
工艺部件	29.91	72.34	32.60	72.68	35.81	72.62	36.05	67.41
结构部件	15.32	20.22	20.48	19.33	31.88	20.09	24.55	17.51
其他部件	-14.13	2.64	1.37	2.81	-0.19	2.78	0.24	11.70
模组	13.15	3.69	16.56	4.08	17.21	3.74	3.45	2.17
表面处理	30.70	1.12	20.73	1.10	40.96	0.76	35.28	1.20
合计	25.19	100.00	28.59	100.00	33.36	100.00	29.13	100.00

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 29.13%、33.36%、28.59%和 25.19%。2024 年度，受下游半导体行业景气周期叠加设备国产化进程加速影响，发行人产能利用率提升，单个产品分摊的固定成本下降，同时发行人产能集中于半导体行业，毛利率较低的其他部件收入占比降低，故主营业务毛利率有所提升。2025 年度、2026 年 1-3 月，发行人主营业务毛利率下降，主要原

因系：1）公司根据市场需求及发展规划进行了适度的产能预增，2025 年起，新增产能所需的基础建设和生产能力已逐步启用，但下游行业在经历 2023 年下半年、2024 年扩产后进入新增产能消纳阶段，下游客户需求阶段性放缓，发行人新增产能未得充分吸收；2）为应对下游客户需求，当年员工规模同比提高，导致薪酬支出增加；3）随着国产半导体设备向先进制程迭代，下游半导体厂商对产品质量要求日益严苛，发行人在多工序、各环节加强质量管控，成本相应上升。

报告期各期，公司主营业务各类主要产品的毛利率变化情况如下：

（1）工艺部件

报告期各期，公司工艺部件毛利率分别为 36.05%、35.81%、32.60%和 29.91%。2025 年，发行人工艺部件毛利率有所下降，主要原因系关键工艺部件以外的其他工艺部件毛利率下降。

报告期各期，发行人关键工艺部件和其他工艺部件收入及毛利率情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率
关键工艺部件	13,035.11	33.24	54,268.14	33.96	46,634.35	34.67	23,412.58	37.36
其他工艺部件	7,334.41	24.00	35,141.19	30.49	35,271.91	37.33	13,667.23	33.80
合计	20,369.51	29.91	89,409.33	32.60	81,906.26	35.81	37,079.81	36.05

2024 年度，发行人关键工艺部件毛利率下滑，主要原因系当期开发加热器新品较多，前期良率较低。2024 年至 2025 年，发行人关键工艺部件毛利率较为稳定。

2024 年度，发行人其他工艺部件毛利率上升，主要原因系半导体行业景气周期下，发行人产能利用率提升，单个产品分摊的固定成本有所下降。2025 年度及 2026 年 1-3 月，发行人其他工艺部件毛利率下降，主要原因系：1）受下游客户需求阶段性放缓，发行人新增产能未得到充分吸收导致；2）随着国产半导体设备向先进制程迭代，下游半导体厂商对产品洁净度等指标要求日益严苛，发行人在多工序、各环节加强质量管控，成本相应上升；3）发行人围绕产

能布局、人才储备高强度投入，子公司先捷航空新建厂房陆续投产、无锡先研新增租用厂房投入使用，带来固定成本增加；4）受客户需求波动影响，发行人为客户配套提供的部分低毛利工艺部件收入上升。

（2）结构部件

报告期各期，公司结构部件毛利率分别为 24.55%、31.88%、20.48%和 15.32%。2024 年，发行人结构部件毛利率上升，主要受益于下游半导体行业景气周期。2025 年度及 2026 年 1-3 月，发行人结构部件毛利率下降，主要原因系：1）受下游客户需求阶段性放缓，发行人新增产能未得到充分吸收导致；2）2025 年结构件新品收入占比提高，新品的订单量相对较少，难以形成批量效应，新品的生产效率相对较低。随着熟练度的提升和客户的需求增加，后续毛利率将得到提升；3）相对较高毛利率的成熟产品销售占比较上年同期有所下降。

（3）其他部件

报告期内，发行人其他部件毛利率分别为 0.24%、-0.19%、1.37%和-14.13%。2024 年起，发行人其他部件主要为医疗零部件及医疗模组，业务培育期成本效益尚未完全释放。

（4）模组

报告期内，发行人模组业务毛利率分别为 3.45%、17.21%、16.56%和 13.15%，2024 年，发行人模组毛利率上升，主要原因系发行人模组业务规模扩大、厂房设备利用率提升，单个产品分摊的固定成本下降。

3、与同行业上市公司毛利率比较

报告期内，公司与同行业上市公司毛利率的比较情况如下：

单位：%

公司简称	毛利率			
	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
富创精密	27.05	22.23	25.80	25.20
珂玛科技	46.15	51.55	58.49	39.93
托伦斯	未披露	27.14	29.89	23.26

公司简称	毛利率			
	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
可比公司平均值	36.60	33.64	38.06	29.46
发行人	25.71	29.02	33.83	29.93

注：数据来自同行业（拟）上市公司公开信息

2023 年至 2025 年度，发行人毛利率先升后降，变动趋势与同行业上市公司基本一致。2026 年 1-3 月，发行人、珂玛科技毛利率下降，变动趋势基本一致；富创精密毛利率上升，主要原因系其境外客户比例较高，受益于下游市场需求回暖，叠加其各生产基地产能爬坡顺利，其收入提升、规模效应体现，带动毛利率提升。

2023 年至 2025 年度，发行人毛利率高于富创精密、托伦斯，低于珂玛科技。发行人与可比公司毛利率差异的主要原因系：（1）富创精密主营产品中，半导体设备模组类产品占比较高，由于模组类产品外购零部件成本占比较大，因此毛利率较低；（2）在产品结构上，托伦斯附加值较低的半导体设备结构部件收入占比较高；（3）珂玛科技主营业务为陶瓷类半导体设备零部件，其上游原材料主要为成本较低的陶瓷粉末，原材料成本较低，加工过程中产生的附加值较原材料成本而言较高，因此毛利率较高；而目前发行人主营业务为金属类半导体设备零部件，尽管在精密加工过程中产生的附加值亦较高，但由于铝、不锈钢等金属原材料成本占比相较于陶瓷粉末而言较高，一定程度上摊薄了整体毛利率水平。

2026 年 1-3 月，发行人、珂玛科技毛利率下降，变动趋势基本一致；富创精密毛利率上升，主要原因系其境外客户比例较高，受益于境外下游市场需求回暖，叠加其各生产基地产能爬坡顺利，其收入提升、规模效应体现，带动毛利率提升。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及占营业收入比例如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	收入占比	金额	收入占比	金额	收入占比	金额	收入占比
销售费用	223.95	0.79	579.67	0.47	664.17	0.58	501.96	0.90
管理费用	1,333.17	4.70	5,395.04	4.36	4,871.63	4.29	3,629.79	6.51
研发费用	1,597.96	5.63	7,137.71	5.77	6,408.32	5.64	3,630.90	6.51
财务费用	175.95	0.62	-116.97	-0.09	-105.20	-0.09	-419.83	-0.75
合计	3,331.03	11.75	12,995.45	10.50	11,838.92	10.42	7,342.82	13.17

报告期内，公司期间费用总额分别为 7,342.82 万元、11,838.92 万元、12,995.45 万元和 3,331.03 万元，占各期营业收入比例分别为 13.17%、10.42%、10.50%和 11.75%，2024 年度，受下游半导体行业景气周期影响，发行人收入规模快速增长，幅度大于期间费用，稀释了期间费用收入占比。

1、销售费用

报告期内，发行人销售费用明细如下表所示：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	72.85	32.53	180.67	31.17	167.18	25.17	164.20	32.71
股份支付	24.09	10.76	96.35	16.62	96.35	14.51	96.35	19.20
业务招待费	74.87	33.43	131.93	22.76	239.18	36.01	109.63	21.84
其他费用	52.14	23.28	170.71	29.45	161.46	24.31	131.78	26.25
合计	223.95	100.00	579.67	100.00	664.17	100.00	501.96	100.00

报告期各期，发行人销售费用金额分别为 501.96 万元、664.17 万元、579.67 万元和 223.95 万元，分别占当期营业收入的 0.90%、0.58%、0.47%和 0.79%，占比较低，主要为职工薪酬、业务招待费和股份支付。2025 年度，公司业务招待费有所下降，主要系受下游需求短期调整影响，公司强化费用管理。

2、管理费用

报告期内，发行人管理费用明细如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	667.80	50.09	2,396.12	44.41	2,032.97	41.73	1,521.28	41.91
股份支付	115.99	8.70	728.23	13.50	803.09	16.49	785.94	21.65
折旧与摊销	79.71	5.98	435.77	8.08	505.68	10.38	519.50	14.31
办公费	97.24	7.29	422.09	7.82	390.07	8.01	226.84	6.25
财产保险费	14.61	1.10	101.57	1.88	35.86	0.74	36.63	1.01
业务招待费	39.33	2.95	77.29	1.43	128.05	2.63	60.38	1.66
中介机构费	17.45	1.31	135.92	2.52	132.25	2.71	75.77	2.09
垃圾处理费	50.08	3.76	183.79	3.41	80.93	1.66	109.01	3.00
残疾人保障金	0.07	0.01	123.01	2.28	71.68	1.47	65.99	1.82
服务费	114.20	8.57	130.01	2.41	65.78	1.35	11.83	0.33
其他	136.69	10.25	661.24	12.26	625.26	12.83	216.61	5.97
合计	1,333.17	100.00	5,395.04	100.00	4,871.63	100.00	3,629.79	100.00

报告期各期，发行人管理费用分别为 3,629.79 万元、4,871.63 万元、5,395.04 万元和 1,333.17 万元，占各期营业收入的比例分别为 6.51%、4.29%、4.36%和 4.70%，主要由职工薪酬、股份支付、折旧与摊销、办公费等构成。报告期内，发行人管理费用总额增长，主要原因系：1）随着公司经营规模扩大和组织结构优化，管理人员数量有所增加，工资、奖金、办公费用相应增长；2）2025 年度，发行人多条表面处理产线投产，危险废物产生量随之增加，相关垃圾处理费提高。

3、研发费用

报告期内，发行人研发费用明细如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	778.21	48.70	3,091.61	43.31	2,484.45	38.77	1,467.53	40.42
股份支付	19.36	1.21	199.54	2.80	163.79	2.56	134.67	3.71
折旧与摊销	32.53	2.04	123.38	1.73	131.17	2.05	85.12	2.34
材料费	753.67	47.16	3,627.68	50.82	3,452.11	53.87	1,860.31	51.24
其他费用	14.19	0.89	95.50	1.34	176.80	2.76	83.26	2.29

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	1,597.96	100.00	7,137.71	100.00	6,408.32	100.00	3,630.90	100.00

报告期各期，发行人研发费用分别为 3,630.90 万元、6,408.32 万元、7,137.71 万元和 1,597.96 万元，主要由研发材料费、研发人员薪酬等构成。发行人高度重视研发活动，前瞻性布局非金属材料、粉末冶金等多个前沿研发方向，研发投入持续增长。

4、财务费用

报告期内，发行人财务费用明细如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息费用	80.14	350.19	218.41	170.03
其中：租赁负债利息费用	3.67	27.38	30.10	20.28
减：利息收入	125.94	578.99	175.71	227.49
汇兑损益	220.18	104.52	-161.24	-370.09
其他	1.57	7.31	13.35	7.73
合计	175.95	-116.97	-105.20	-419.83

报告期各期，发行人财务费用分别为-419.83 万元、-105.20 万元、-116.97 万元和 175.95 万元，主要为借款利息费用、融资租赁利息费用和汇兑损失。

报告期内，公司存在外销，主要结算货币为美元，汇兑损益主要由美元的汇率波动产生。

（五）其他影响经营成果的主要项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	60.72	566.76	457.61	528.56
直接减免的增值税	-	-	0.23	1.50
进项税加计抵减	34.37	437.69	424.63	140.26
代扣个人所得税手续费	14.86	7.42	17.37	9.94

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合计	109.95	1,011.87	899.84	680.26

报告期内，公司其他收益分别为 680.26 万元、899.84 万元、1,011.87 万元和 109.95 万元，主要由收到的政府补助、增值税进项税加计抵减等构成。

2、信用减值损失

报告期内，发行人信用减值损失具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收票据坏账损失	-1.57	-	-	-
应收账款坏账损失	-259.76	160.40	957.19	396.21
其他应收款坏账损失	-6.95	25.45	8.19	16.41
合计	-268.27	185.86	965.38	412.63

发行人信用减值损失主要为应收账款坏账损失。2024 年度，受益于下游半导体行业景气周期，发行人营业收入同比增长 103.65%，期末应收账款账面余额同比增长 16,927.61 万元，计入当期损益的应收账款坏账损失随之增加。2025 年末，发行人期末应收账款余额同比增长 4,014.31 万元，计入当期损益的应收账款坏账损失降低。

3、资产减值损失

报告期内，发行人资产减值损失金额分别为 156.50 万元、945.05 万元、1,198.39 万元和 919.11 万元，均为存货跌价损失及合同履约成本减值损失，随发行人业务规模扩大，期末存货规模增长，库龄略有上升，存货跌价损失相应上升。

4、资产处置收益

报告期内，发行人资产处置损益分别为 1.02 万元、-38.56 万元、20.04 万元和-7.12 万元，主要为固定资产处置损益和使用权资产处置损益，金额较低，对发行人整体业绩无重大影响。

5、营业外收入

报告期内，发行人营业外收入分别为 0.00 万元、0.50 万元、0.06 万元和

0.10 万元，为偶发的违约金及赔偿收入，金额较低。

6、营业外支出

报告期内，发行人营业外支出具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产毁损报废损失	0.58	0.51	23.02	41.70
对外捐赠	-	-	2.06	0.71
其他	2.79	2.71	10.02	20.45
合计	3.37	3.22	35.09	62.86

报告期内，发行人营业外支出分别为 62.86 万元、35.09 万元、3.22 万元和 3.37 万元，主要为非流动资产毁损报废损失。

（六）非经常性损益分析

报告期内，发行人非经常性损益项目情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7.70	19.53	-61.57	-40.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-	313.27	99.69	123.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.69	-2.65	-11.58	-21.16
小计	-10.39	330.15	26.54	61.33
减：所得税影响额	-1.13	49.29	5.20	12.37
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-	-
合计	-9.26	280.86	21.35	48.96
非经常性损益金额占当期归属于母公司股东的净利润比例	-0.37	1.49	0.10	0.61

报告期内，发行人归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 48.96 万元、21.35 万元、280.86 万元和-9.26 万元，占当期归属于母公司股东的净利润比例分别为 0.61%、0.10%、1.49%和-0.37%，主要由计入当期损益的政府补助构成。公司非经常性损益金额占当期归属于母公司股东净利润的比例较低，对盈利能力影响较小。

（七）发行人现金流量分析

报告期内，发行人现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,241.30	19,693.83	10,484.27	13,607.40
投资活动产生的现金流量净额	-14,807.12	-28,693.32	-13,140.89	-9,133.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,232.72	244.32	52,396.30	-1,788.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181.21	-75.64	126.73	426.08
现金及现金等价物净增加额	-17,996.92	-8,830.80	49,866.41	3,111.04

1、经营活动现金流量分析

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
销售商品、提供劳务收到的现金	16,622.82	91,186.24	80,453.23	47,443.56
收到的税费返还	213.10	249.09	143.91	63.93
收到其他与经营活动有关的现金	410.04	910.90	5,403.48	7,243.28
经营活动现金流入小计	17,245.96	92,346.23	86,000.62	54,750.77
购买商品、接受劳务支付的现金	12,095.98	34,674.33	42,131.01	20,002.25
支付给职工以及为职工支付的现金	7,031.93	24,644.27	17,336.93	10,111.19
支付的各项税费	1,722.78	6,993.22	7,994.25	2,338.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,636.56	6,340.57	8,054.16	8,691.23
经营活动现金流出小计	22,487.26	72,652.40	75,516.35	41,143.37
经营活动产生的现金流量净额	-5,241.30	19,693.83	10,484.27	13,607.40

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 13,607.40 万元、10,484.27 万元、19,693.83 万元和-5,241.30 万元。发行人经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，与公司收入增长基本匹配。

2024 年度较 2023 年经营活动现金流量净额减少，主要原因系：2024 年收入大幅增长，为保证订单交付，公司新招聘较多员工，当期支付的人力成本大幅增加；收入的大幅增加同时使销售回款及采购支付款项同步增加；

2025 年度较 2024 年度经营活动现金流量净额增加，主要原因系：公司收

到的客户回款金额增加，同时 2025 年收到的其他与经营活动相关的现金大幅减少，该部分金额主要为公司使用从客户端收到银行承兑票据支付采购部分款项，而 2024 年银行调整了该类票据的结算模式，取消了之前的票据保证金，公司自 2024 年开始逐步推行并在 2025 年彻底执行。

2026 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额转为负数，主要系受下游行业需求波动影响，公司当期销售收到的回款减少，而 2026 年二季度起下游行业有所回暖，为应对增长的在手订单，公司提前排产，所产生的经营活动现金流出增加。

报告期内，发行人净利润与经营活动现金流量净额的匹配情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	2,477.18	18,889.58	21,394.62	8,027.50
加：信用减值损失	268.27	185.86	965.38	412.63
资产减值准备	919.11	1,198.39	945.05	156.50
固定资产折旧	1,354.04	4,468.26	3,320.57	2,586.77
使用权资产折旧	111.62	445.81	292.69	159.40
无形资产摊销	41.00	106.51	148.09	152.58
长期待摊费用摊销	207.19	818.44	486.70	385.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	7.12	-20.04	38.56	-1.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.58	0.51	23.02	41.70
财务费用（收益以“－”号填列）	300.32	454.71	57.16	-200.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-202.97	-331.69	-77.16	-555.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-0.59	2.86	-204.12	-13.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,143.82	-4,940.02	-9,918.46	-565.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,290.69	-3,940.73	-25,395.68	-9,533.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,528.55	1,105.71	14,138.42	9,893.06
其他	181.79	1,249.68	4,269.43	2,662.08
经营活动产生的现金流量净额	-	19,693.83	10,484.27	13,607.40

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	5,241.30			

报告期各期，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异主要来自于经营性应收应付项目、存货金额的变动和计提的折旧摊销。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，发行人投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.35	117.60	156.26	13.94
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,640.00	1,640.00	560.00
投资活动现金流入小计	0.35	1,757.60	1,796.26	573.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,807.48	27,687.18	13,297.15	9,147.80
投资支付的现金	-	-	-	0.001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,123.74	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,640.00	1,640.00	560.00
投资活动现金流出小计	14,807.48	30,450.92	14,937.15	9,707.80
投资活动产生的现金流量净额	-14,807.12	-28,693.32	-13,140.89	-9,133.86

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，表现为净投资。报告期内，发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额持续增长，主要原因系：1）随着半导体设备国产化进程的不断推进，国内半导体设备厂商产品技术更新迭代快，公司新建多间厂房、购置大量机器设备，用于工艺能力提升及新产品研发、生产；2）2024 年末，发行人首发募集资金到位，首发募投项目建设投入相应增加。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，发行人筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	-	-	53,694.45	-

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	2,397.70	10,675.21	3,900.00	3,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	41.16	29.11	-
筹资活动现金流入小计	2,397.70	10,716.37	57,623.55	3,500.00
偿还债务支付的现金	-	4,495.00	3,000.00	4,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74.44	4,459.45	188.25	151.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	90.54	1,517.60	2,039.01	237.44
筹资活动现金流出小计	164.98	10,472.05	5,227.26	5,288.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,232.72	244.32	52,396.30	-1,788.57

报告期内，发行人筹资活动产生的现金流入主要系首发募集资金到账及取得借款收到的现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金。2024年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较高，主要原因系公司于年内收到首发募集资金。

综上，报告期内，公司现金流量的变动情况与经营状况基本相符。

八、资本性支出分析

（一）报告期内公司重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 9,147.80 万元、13,297.15 万元、27,687.18 万元和 14,807.48 万元，公司重大资本性支出主要投向为首次公开发行股票募投项目。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的资本性支出项目主要为公司前次募集资金投资项目的继续投入、本次募集资金计划投资的项目、半导体先进涂层产业化项目和民用航空航天结构件开发制造项目。公司前次募集资金投资项目及本次募集资金计划投资的项目具体情况详见募集说明书“第七节 本次募集资金运用”“第八节 前次募集资金的使用情况”。

除上述募投项目外，公司计划进一步增强适用于半导体零部件的先进涂层表面处理能力，实施“半导体先进涂层产业化项目”，项目预计首期投资金额为 5,000 万元人民币，以适配下游客户日益严苛的表面处理要求；此外，公司拟利用现有零部件制造技术和经验积累，实施“民用航空航天结构件开发制造项目”，项目预计首期投资金额为 10,000.00 万元人民币，积极应对国内蓬勃发展的航空航天产业需求，为航空航天领域客户提供高性能结构件产品。

（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

报告期内，公司通过募投项目的实施，将核心技术深度应用于丰富的半导体客户场景及广泛的下游制程领域，针对更高制程需求，持续对核心产品进行升级迭代，进一步丰富产品结构，提高产品质量及精度、满足客户日益提升的需求。前次募投项目和本次募投项目聚焦半导体设备核心精密零部件关键技术突破与产能升级，巩固和提升公司的市场地位。

此外，公司一方面自建半导体先进涂层产能，提高半导体零部件特种表面处理能力；另一方面，公司将在半导体零部件领域积累的经验和优势进一步扩展至航空航天领域，为国内航空航天事业增添助力。

九、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司技术先进性及具体表现详见募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“九、与产品或服务有关的技术情况”。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司正在从事的主要研发项目及进展情况如下：

单位：万元

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
PECVD 设备核心部件加热气体分配器制造工艺研发	项目即将结项，已完成研发件试制、PPAP 验证，核心技术指标达标，完成规模化生产方案制定，相关专利申报推进中，量产筹备工作已落地，各	研发 PECVD 设备核心部件加热气体分配器，整合传统气体分配器与高温晶圆加热器，开展仿真、结构设计、	实现加热气体分配器国产化并达国际水平，孔径标准差、粗糙度、温均性达既定指标，年量产 1500 套、年产值 5000 万元，申报 2 项以上相	优于客户标准	半导体 PECVD 机台设备	755

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
	项既定任务即将全部完成。	APQP 策划及试制验证, 攻克孔径、温均性等技术难点, 推动国产化量产。	关专利。			
金属硅化物毫秒级退火设备组件研发	无磁材料验证、焊接结构设计阶段	此项目拟通过无磁性材料及焊接后磁性验证进行相关产品开发。	保证客户设备运行不受磁力影响	优于行业标准	关键工艺部件	1,050
一种半导体快速退火设备 (RTP) 蜂窝灯源阵列部件研发	焊接结构优化, 第二轮样品制作	结合 RTP 设备退火工艺需求 (适配 12 英寸晶圆、毫秒级退火、精准温控), 设计蜂窝灯源阵列焊接、加工、检测等工艺方案。	确保蜂窝灯源阵列部件无任何泄漏点, 各通道尺寸完全符合客户装配要求, 最终实现灯源均匀性 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ (1100°C 环境下), 升温速率 $\geq 200^{\circ}\text{C/s}$, 降温速率 $\geq 80^{\circ}\text{C/s}$, 使用寿命 ≥ 20000 小时。	优于客户标准	半导体快速退火设备	780
次常压化学气相沉积设备核心部件研发	工艺研发已完成, 开始将工艺应用于部分实验产品。	此项目为设计、材料和制造工艺的优化, 应用与核心部件生产。	实现设备的低压力、低温度运行, 提高设备的性能、稳定性和寿命, 实现客户次常压化学气相沉积设备核心组件的国产化。	优于客户标准	关键工艺部件	735
先进制程匀气盘开发及成熟制程匀气盘研发	项目进展 30%, 基础能力搭建中, 正在测试分项制造能力, 微孔位置度以及孔内粗糙度。	开发适用先进制程薄膜沉积设备用的关键零部件气体分配器。	攻克面向 5nm 及以下先进制程的高性能匀气盘制造关键技术, 完成产品研发、中试验证与客户导入, 建成一条技术安全、具备批量供应能力的示范生产线, 实现高端匀气盘的国产化, 关键性能指标达到国际主流产品水平。	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD 机台等设备	850
铝基碳化硅 ESC 基座研发	项目进展 50%, CNC 加工能力, 喷涂能力已经搭建完成, 当前正在开发焊接工艺。	开发适用高低温频繁变换工艺温度的刻蚀机设备用的 ESC 基座。	攻克铝基碳化硅 ESC 基座的材料配比、精密焊接、超精密加工、特种喷涂等核心技术, 开发出满足超低温刻蚀工艺需求的产品, 通过中微公司、北方华创、H 公司等目标客户的产品验证, 形成稳定的批量生产能力, 实现铝基碳化硅 ESC 基座的	优于客户标准	半导体刻蚀设备	380

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
			国产化，关键性能指标达到国际先进水平。			
半导体设备用陶瓷静电吸盘开发	项目进展 30%。已开展静电吸盘的需求调研与指标定义。已初步完成研发项目核心技术团队的搭建。已开展陶瓷静电吸盘主要工艺技术路线的行业调研，并已完成主要工艺技术路线的确定。已经与客户明确一款带加热功能的静电吸盘产品的开发任务，并已完成这一款产品的设计、模拟工作，产品开发正在进行中。	开发一种广泛应用于半导体工艺中的陶瓷 ESC，主要内容包括：介电层陶瓷材料性能的精准调控；介电层与电极层的制备技术；介电层、电极层与基座的连接技术；静电吸盘介电层的表面处理技术；静电吸盘热区分布、电极层设计的模拟技术；静电吸盘各项技术性能指标测量方法和标准的建立。	介电层电阻率：库伦型 $>E+14\Omega\cdot\text{cm}$ ，J-R 型 $E+9\sim E+12\Omega\cdot\text{cm}$ ； 介电强度：库伦型 $\geq 20\text{kV/mm}$ ，J-R 型 $\geq 15\text{kV/mm}$ ； 工作面平面度 $\leq 5\mu\text{m}$ ； 最大吸附力 $\geq 200\text{gf/cm}^2$ 。	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD 机台等设备	2,985
半导体电子束量测设备零部件开发	项目进入零部件试制阶段，选取的零件工艺已确定，产品工装制作中。	自主研发具有国际竞争力的前道电子束量测设备。	满足客户图纸设计要求和检测；改善加工工艺，提高成品率，提高加工效率，降低成本。	优于客户标准	半导体电子束量测设备领域	180
化学镍旋流搅拌过滤工艺研发	已完成工艺设计、产线试产，已完成部分客户盘类工艺件的生产首件测试。	项目核心围绕化学镍旋流搅拌过滤工艺开展全流程研发，覆盖“工艺设计—设备适配—参数优化—中试验证—技术沉淀”全环节。	形成 1 套可工业化应用的旋流搅拌过滤工艺方案，配套研发 1 套中试级专用设备，确保工艺稳定可靠、环保达标，可直接适配工业级化学镍废液处理场景。	优于行业标准	半导体薄膜设备（CVD、ALD 等）核心工艺部件	825
刻蚀设备零部件的铝合金钝化工艺开发	已完成全流程研发与验证，实现无铬钝化工艺固化并达成批量生产条件，各项技术指标均验证达标。	针对刻蚀设备零部件研发铝合金无铬钝化工艺，完成新型无铬钝化剂筛选与配方优化，确定最佳工艺参数，依次开展实验室小试、中试生产验证工艺可行性，	研发出适配刻蚀设备零部件的环保高效铝合金无铬钝化工艺，膜层耐蚀性、附着力等性能超传统含铬工艺，工艺流程简化且生产无污染，实现工艺固化与批量生产，满足相关零部件的工业化应用需求。	优于客户标准	半导体刻蚀设备	545

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
		优化工艺流程后实现工艺固化，达成产业化批量应用。				
铝基晶圆加热器表面耐高温氟化铝涂层工艺研发	项目处于研发阶段，已完成目标制定、技术调研与研发路线确认，正开展氟化铝涂层工艺筛选及基本性能测试工作，按计划推进配方试制相关研究。	研发铝基晶圆加热器表面耐高温氟化铝涂层工艺，含涂层工艺与配方设计、制备工艺探索、性能测试评估，同时制定规模化生产方案，解决涂层高温可靠性、均匀性等技术难点。	实现铝基晶圆加热器耐高温氟化铝涂层国产化，解决铝离子超标等问题，提升加热器性能，量产后预计年销 2000 套，年产值约 4000 万元，申请 2 项以上相关专利。	优于客户标准	半导体 PECVD 机台设备	1,050
半导体设备零部件用先进陶瓷涂层和新工艺开发	项目进展 70%，YF3、YOF、YAG 涂层工艺已完成开发，新的涂层工艺已确定超致密涂层的设备和 EB-PVD 设备的采购，AD 工艺目前在进行调研和实验中，氧化钇粉国产化已经完成前期基础工作，目前正在推进客户验证。	本项目拟采用 APS、HVOF、以及 ALD 工艺，开发喷涂型静电吸盘所需的高性能氧化铝涂层。通过 APS 工艺，采用适配的原料粉末，经过喷涂工艺参数的优化，做好喷涂 YF3、YAG、YOF 涂层的技术储备。本项目拟和国内氧化钇粉末厂家共同开发半导体级别高纯氧化钇粉末，并对熔射后的结果进行系列检测和实验。	喷涂型氧化铝静电吸盘满足客户要求的技术指标；做好 YF3、YOF、YAG 等新涂层开发的技术储备。涂层新工艺 SPS、HVOF、AD、EB-PVD 等做好技术储备。实现国内高纯氧化钇粉末熔射的产品各项性能指标达到进口粉末产品同等水平，为后续全产业链国产化做好准备工作。	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD 机台等设备	900
高性能微弧氧化膜制备工艺与技术研发	项目处于研发收尾阶段，已完成工艺参数优化、设备研发与膜层性能测试，正优化工艺流程，即将完成验收总结并申报相关专利，整体开发接近尾声。	针对半导体设备零部件耐腐蚀、耐高温的需求，研发铝合金微弧氧化工艺，优化工艺参数与制备设备，检测分析氧化膜性能，优化工艺流程，研发自主知识产权	研发适配半导体设备零部件的铝合金微弧氧化工艺，提升氧化膜防腐、耐热冲击性能，形成自主知识产权的工艺技术及设备，实现氧化膜性能稳定达标。	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD 机台等设备	480

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
		的工艺技术及设备。				
高性能刷镀镍工艺研发	完成了多种刷镀镍液配方的测试，分析了影响工艺质量的过程因素（温度、杂质、速度、电流等），目前正在进行定制化刷镀机的设计开发。	本项目聚焦高性能刷镀镍工艺的全链条研发，突破传统刷镀镍工艺在环保性、稳定性、功能性上的核心瓶颈，整合材料配方、工艺参数、装备适配、质量管控四大维度，形成一套可产业化、适配多场景的高性能刷镀镍技术体系。	1. 完成高性能刷镀镍工艺的中试验证，建立中试生产线，实现批量生产适配，中试产品合格率 $\geq 97\%$ ，形成可直接转化的产业化技术方案，解决工艺规模化应用中的稳定性、成本控制等问题。2. 优化工艺成本，使高性能刷镀镍的单位成本较进口同类工艺降低 20%-30%，较传统刷镀镍工艺降低 10%以上，提升产品市场竞争力。	优于客户标准	半导体刻蚀类设备核心工艺部件	520
铝合金高致密氧化工艺研发	项目已完成全部研发工作，完成工艺参数固化、小型零件认证测试及实验室成果转化，形成自主知识产权的工艺技术与氧化膜性能检测报告，正式结项。	针对半导体设备用铝合金零部件，开展原材料选型、表面预处理、阳极氧化工艺及槽液优化，研发膜层封闭技术，经多轮样块实验与性能测试，最终固化核心工艺参数，形成完整工艺方案。	研发适配半导体设备的铝合金零部件的高致密阳极氧化工艺，实现膜层厚度、致密性等核心指标达标，显著提升铝合金耐腐蚀、耐热冲击及耐击穿性能，满足零部件高温工况使用需求。	优于行业标准	半导体刻蚀、CVD、PVD 机台等设备	380
刻蚀机零部件先进表面加工工艺开发	项目进展 30%，氧化钇涂层耐盐酸腐蚀满足要求，氧化铝涂层性能提升有待进一步改进和验证。	本项目拟采用大气等离子喷涂 APS 工艺，对刻蚀机设备零件表面进行陶瓷涂层加工，制备满足性能要求的氧化钇和氧化铝陶瓷涂层。通过对大气等离子喷涂后的陶瓷涂层，进行精细的磨削机加工，来满足客户的图纸要求，制备尺寸精	项目预期实现的目标： (1) 氧化钇涂层的耐盐酸（浓度 5%）腐蚀时间 > 5 小时； (2) 氧化铝涂层的孔隙率 $< 2.5\%$ ； (3) 氧化铝涂层耐低温性能指标：在低温箱最低温度需低于 -80°C ，在高温箱最低温度需要高于 50°C ，两箱温冲 ≥ 5 次。试验后使用紫外灯检查涂层外观，要求无损	优于行业标准	半导体刻蚀设备	600

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
		度和表面外观满足客户要求的刻蚀机设备零部件。	伤。			
高致密零孔隙 ALD 镀膜工艺研发	项目进展 30%。已完成进口和国产 ALD 设备的采购，设备预计 2026 年下半年安装就位并具备实验测试条件。已利用外部设备资源开展 ALD 镀膜打样试验。	研发高致密零孔隙 ALD 涂层技术，提高涂层致密性和附着力，减少孔隙和缺陷，增强耐腐蚀性和稳定性。确保大规模生产中涂层的均匀性和稳定性，通过精确控制工艺参数和优化设备设计，采用先进传感器和控制系统实时监测和调整工艺参数。	开发高效 ALD 沉积工艺，缩短周期，提高生产效率；优化前驱体传输和反应器设计，增强工艺稳定性；实现薄膜厚度、成分和结构的精准控制，满足高端零部件性能要求，确保涂层表面质量，提高电气性能和耐高压性能。	优于客户标准	半导体零部件（SHD、加热器）	1,050
半导体设备用铸铝加热器研发	项目进入收尾阶段，已完成小批量生产，各项性能检测达标，首样通过客户验收，正推进量产落地与标准作业指导书落地，完成全部研发节点。	开展半导体铸铝加热器结构、浇铸工艺等研发，攻克材料调配、焊接、模具设计等难点，完成试模、表面处理及性能检测，实现小批量试制与客户验证。	实现铸铝加热器国产化并达国际水平，温度均匀性 $\leq \pm 0.5\%$ ，产品无外观及内部缺陷，可真空使用，成膜效果优异，达成年量产 3000 套、年营收 6000 万元目标。	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD 机台等设备	680
半导体设备晶圆陶瓷加热器开发	开发进行中，首件测试样件已交给客户进行测试，其他款产品正在准备交付客户首件进行测试验证。材料关键性能和关键结构参数控制在继续优化中。	开发一种广泛应用于半导体工艺中的 AlN 陶瓷加热器。主要开发内容包括：高性能 AlN 材料及制备技术的开发，满足热场均温要求和一定使用寿命的加热丝设计和制造，及多层 AlN 加热器制造工艺技术开发。	温度均匀性： $450^{\circ}\text{C} < 5^{\circ}\text{C}$ ； $550^{\circ}\text{C} < 5^{\circ}\text{C}$ 550 $^{\circ}\text{C}$ 体电阻： $\geq 5\text{E}8\Omega \cdot \text{cm}$ mesh 网平整度： $\leq 0.15\text{mm}$ 表面平面度： $< 10\mu\text{m}$	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD 机台等设备	1,050
半导体光刻、刻蚀及薄膜沉	处于研发攻关阶段，产品需求规格书编制与详细技术方案设计	本项目聚焦半导体光刻、刻蚀及薄膜沉积设备用	技术上实现加热棒功率密度至 $32\text{w}/\text{cm}^2$ ，25-500 $^{\circ}\text{C}$ 控温精度	优于客户标准	半导体光刻、刻蚀、	800

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
积设备用流体加热器工艺研发	已完成，正在推进样机试制、测试验证，已有三款样件送至客户端验证。	流体加热器工艺研发，围绕铝装加热管、高功率密度加热棒、陶瓷加热板、铸铝成型流体加热器四类核心产品，针对国产同类产品精密铸造缺失、材料处理工艺不足、制造精度低、一致性控制弱等核心问题，从材料、结构、控温、集成四个维度推进技术优化与工艺突破。	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 内，批量性能偏差 $\leq 5\%$ ，连续运行寿命 ≥ 3 年，升温响应 $\leq 4\text{S}$ ，集成智能化功能并实现高端材料国产化。产业化上实现产品批量生产、性能达国际水平，建成小批量产线。		CVD、PVD 机台等设备	
放疗设备用头框架零部件制造工艺开发	开发进行中，关键部件样件已完成交付客户验证。	此项目为多种类零件的制造和表面处理等工艺的验证和开发。	提高产品质量，实现稳定的产品交付能力，为承接更多同类型高端医疗客户业务形成技术能力。	优于客户标准	医用直线加速器	600
半导体快速热处理设备组装开发	开发进行中，首批次模组系统已交付客户，关键数据验证中。	此项目拟通过进行关键部件等离子喷涂工艺开发、组装、测试等集成配套工艺，完成相关产品验证。	保证客户对于真空泄漏、反射率等热处理设备性能指标要求的提升，可实现国产化能力以及批量供货的目标。	优于客户标准	半导体热处理设备	345
半导体光刻机设备精密零部件开发	工艺开发完成，试验件尺寸加工验证中。	此项目涉及到公司历史上较少加工的钛合金、不锈钢等材料，以及所需产品的形位公差达到 2-5 微米的精度，需要突破公司在加工制造工艺上的突破，并形成稳定可靠的量产技术能力。	攻克难加工材料镍基合金的超精密加工，开发出满足 EUV 光刻机使用的平台框架，H 公司等目标客户的产品验证，助力实现国产 EUV 光刻机的制造，关键性能指标达到国际先进水平。	优于行业标准	EUV 光刻机	580

（三）保持持续技术创新的机制和安排

1、建立了三大技术革新反馈机制

技术创新的动力来自客户及市场需求，公司经过多年与下游头部客户的深度合作，与客户建立了技术革新反馈机制。首先，公司会派出工程师在主要客户处长期驻场，第一时间了解客户对公司产品瑕疵、性能更新需求等，通过该机制，公司能够及时掌握下游客户的发展动态；其次，在与客户的不断沟通交流中实现双方产品的协同及共同迭代进步，因此，公司还与客户建立了合作开发新工艺的机制，即公司会不定期地与客户协同开发重点产品及新工艺研发、验证和应用，通过该机制，一方面公司能够明确技术更新迭代方向，加快技术研发，另一方面也能帮助国产设备厂商加快完成产品的研发和设计。

除与客户建立技术革新反馈机制外，公司也建立了与供应商的技术革新反馈机制。由于半导体设备零部件工序繁多且专业度高，即使是行业龙头也无法覆盖全部生产工序，但公司是向客户交付最终合格产品的第一责任人，因此，公司需要整合多方产业资源，为客户提供优秀的产品解决方案。基于此，公司通过深耕行业，积累了一批长期合作的外协供应商，不断根据客户需求研究技术更新，带领供应商共同发展，在相互配合中共同突破工艺瓶颈、迭代升级。

除上述两大反馈机制外，公司还建立了全平台技术革新反馈机制，即通过全员合理化建议的实施，公司在研发、工程和生产部门间建立了有效、通畅的沟通渠道，定期对员工提出的优化改善措施进行评估和奖励，极大地激发员工创新行动热情。通过该机制，公司将研发和生产两者有机结合，相辅相成，加速完善技术研发的同时，保证了技术研发有效地转化为生产力，进一步丰富了高科技制造型企业的创新路径。

综上，公司通过上述与客户、与供应商、与员工建立的三大技术革新反馈机制，形成了一个以高端零部件为载体的，多工艺联合研发创新和生产的生态系统，在该生态系统下，公司能够以较快的响应速度及具有竞争力的价格为客户提供高质量的产品，上述机制系公司研发和技术创新的主要机制。

2、前瞻性研究、产品导向、工艺迭代有机结合的研发框架

公司高度重视研发创新活动，设立了专门的研发中心主导工艺和产品开

发。公司由首席技术官主持统筹研发中心的研发创新活动，下辖研发管理部、研发一部、研发二部、研发三部和研发四部，具体部门职责如下：

一级部门	二级部门	职责简述
研发中心	研发管理部	1、各级横向及纵向课题、项目的对接和管理。2、研发体系的管理。3、和其他部门日常事务的对接和管理。
	研发一部	1、负责产品的设计及模拟。2、负责金属加热类产品的研发、新品工艺制定及工艺技术支持等工作。3、负责本部门开发产品、工艺标准的制定
	研发二部	1、负责新材料类产品的研发。2、负责陶瓷类材料及产品的研发。3、负责干法表面处理研发和工艺技术支持。4、负责本部门开发产品、工艺标准的制定
	研发三部	1、负责公司各品类产品精密加工工艺的开发。2、负责SHD 产品开发。3、负责本部门工艺标准的制定。
	研发四部	1、负责湿法表处工艺的开发和工艺技术支持。2、负责公司实验室建设和管理。3、负责公司理化性能检测。4、负责本部门工艺标准的制定。

报告期内，公司研发投入金额分别为 3,630.90 万元、6,408.32 万元、7,137.71 万元和 1,597.96 万元，保持持续增长，占各期营业收入的比例分别为 6.51%、5.64%、5.77%和 5.63%。截至 2026 年 3 月末，公司研发人员 149 人，占员工总数的 8.80%。公司未来将持续加大研发投入，为持续创新和技术储备提供保障。

3、强化知识产权，保护自有知识产权

公司高度重视核心技术和知识产权的保护，不断强化知识产权管理。公司内部所有技术文件均经过保密处理，有严格的审批解密管理流程。同时，公司及时对研发形成的专利技术、软件申请专利权和软件著作权。通过技术保密和知识产权申请等手段相结合，对公司核心技术进行保护。

十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

截至 2026 年 3 月 31 日，发行人不存在尚未了结的或可预见的对财务状况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、仲裁、诉讼、其他或有负债和重大期后事项。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》，募集说明书所指的“重大诉讼、仲裁”系指涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计总资产或者市值 1%以上的未决诉讼、仲裁案件。

十一、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次发行完成后，随着募集资金投资项目的实施，公司的业务和资产规模会进一步扩大。本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务开展，募集资金投资项目均基于公司现有业务基础及技术储备而确定，公司的主营业务未发生变化，不存在因本次向不特定对象发行可转债而导致的业务及资产的整合计划。

（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目均基于公司现有业务基础及技术储备而确定，有利于公司保持并进一步提升自身的生产实力和科技创新能力。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行完成后，公司的实际控制人仍为游利，公司控制权不会发生变化。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目计划

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目	30,401.55	28,750.00
2	半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目	26,470.57	25,050.00
3	半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	5,911.37	5,200.00
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		78,783.49	75,000.00

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目

1、项目基本情况

本项目的实施主体为江苏先锋精密科技股份有限公司，建设地点位于江苏省靖江市斜桥镇，项目总投资额为 30,401.55 万元，拟使用本次募集资金金额

为 28,750.00 万元。

本项目旨在通过新建高标准厂房及百级洁净车间、大规模引进多轴联动数控加工中心等先进生产与检测设备，升级真空扩散焊等特种工艺能力，构建更高标准的规模化、自动化、洁净化的精密制造基地，以突破产能瓶颈并满足更高制程对金属加热器等高端器件的严苛需求。

本项目除将重点扩建金属加热器产线外，还将同时配套扩大匀气盘等关键工艺部件产能，以满足下游客户日益紧迫的国产半导体设备突破创新需求。

2、项目实施的必要性

（1）突破现有产能瓶颈，满足下游客户持续增长订单需求

当前，在全球半导体产业链区域化重构和国产化战略深入推进的双重驱动下，国内半导体设备市场呈现出强劲的增长态势。以刻蚀、薄膜沉积为代表的前道核心设备需求持续攀升，拉动了对金属加热器等关键工艺器件的采购需求。公司作为国内少数能够进入主流设备商供应链并实现批量交付的供应商，已与中微公司、北方华创、拓荆科技等行业龙头建立了稳固的合作关系。来自该些战略客户的订单持续、快速增长，公司业务的销售收入从 2023 年的基础量级扩张至 2025 年的 10 亿元以上规模，未来增长预期明确。

随着公司业务规模在持续扩大，现有厂房已无法满足现有工艺需求，部分工艺开始依赖于租赁厂房。在现有设备布局与工艺流程下，租赁厂房的产能潜力已得到充分挖掘，进一步拓展的空间较为有限。目前生产区域内的物料流转与在制品暂存空间已趋近于最大容量，若继续在当前条件下增设设备，对产能提升的边际效应将明显减弱，甚至可能影响现有的生产效率。此外，在租赁场地上进行重大设备投资，始终面临租约到期无法续租、租金上涨或场地被收回的经营不确定性。这种不确定性抑制了公司进行长期、重型资产投资的意愿，影响了生产布局的优化和工艺深化的节奏，从战略上制约了公司的核心竞争力建设。实施本次产能扩建项目，将有效释放公司生产潜能，为现有成熟工艺提供制造土壤。

项目建成后，公司将拥有充足的物理空间与先进产能，不仅能应对现有客户订单的持续增长，更能主动规划并匹配客户未来的扩产节奏与技术升级需

求。这将显著提升公司的供应链保障能力与快速响应能力，使公司在与核心客户的战略协同中扮演更为关键的角色。通过产能的规模化与专业化升级，公司将有能力承接更大规模、更高要求的订单，从而进一步深化与客户的合作层次，从单一产品供应向深度协同研发与系统化解决方案延伸，并为核心业务市场份额的持续提升与公司整体战略目标的实现，提供稳定的产能基础与竞争优势。

（2）建设高标准洁净车间，应对先进制程严苛环境要求

随着半导体制造技术的持续演进，产业对生产环境与核心器件性能的标准正在进行更高要求的变化。一方面，在先进制程工艺中，即使亚微米级的颗粒污染也可能导致产品缺陷，因此，为核心器件的制造、清洗、装配及测试环节提供百级甚至更高标准的洁净环境，已成为确保终端产品良率与设备运行可靠性的先决条件。另一方面，为满足更高功率密度、更优热匹配及更强耐腐蚀性等需求，新型复合材料开始被引入器件设计，其加工工艺与连接技术，对生产环境的洁净度、温湿度稳定性及防微振控制提出了前所未有的严苛要求。租赁厂房在空气洁净度、温度、湿度等关键环境参数上较难实现升级改造，难以构建和维持稳定的环境。这直接导致涉及的超高纯清洗、表面处理等关键工序无法在公司内部完成，产品洁净度无法达到客户规格，成为获取高端订单的首要障碍。在此背景下，公司现有租赁厂房的局限性，已构成实质性瓶颈。

项目将重点规划并建设符合百级、万级洁净标准的专业化生产车间，并系统地引入适配新材料、新工艺的特种加工与处理单元。这不仅是对公司现有制造能力的一次升级，更是构建面向未来的核心竞争力。通过建设高标准洁净制造环境，公司将能够确保其产品洁净度、材料性能与可靠性等维度满足更加严苛规范。此举将使公司有能力参与客户关键核心零部件的同步设计与迭代，从源头确立技术协同优势。这不仅能够巩固与现有战略客户的合作黏性，更能提升公司在高端市场的品牌形象与技术声誉，为开拓更广阔的半导体先进制程器件市场奠定坚实的基础，最终将技术门槛转化为可持续的行业领导力与市场份额。

（3）规模化生产与管理升级，提升整体运营效率

当前，公司业务已进入规模化、高质量增长的关键阶段。然而，现有的分散式生产布局，在物料流转、生产协同、环境管控及管理精细化等方面逐渐暴露出瓶颈，制约了运营效率的进一步提升与规模效应的充分发挥。

项目通过新建集中式厂房，将目前分散的各项工序进行一体化布局。这种集约化的设计，将从根本上优化内部物流路径，为推行精益生产和标准化作业提供理想的物理空间基础。为生产计划的顺畅执行、设备的高效协同以及生产过程的透明化管理创造了前提条件。

项目将引入自动化加工与检测单元。在扩大产能规模的过程中，公司并非进行简单的设备数量叠加，而是致力于推动生产模式的转型。这不仅能显著提升关键设备的综合利用率，降低单位产出对直接人工的依赖与干预，更能有效减少人为差错，提升生产效率，使大规模生产下的质量与成本控制成为可能。

本项目通过产能的集中化建设、生产过程的自动化升级与运营管理的数字化赋能，将构建一个高效、可控的现代化制造体系。该体系将直接支撑公司在业务规模扩张过程中，实现运营效率的持续提升、产品质量的稳定可靠以及综合成本的优化控制，形成可持续的规模化竞争优势。

3、项目实施的可行性

（1）契合产业链安全的战略导向

半导体金属器件作为高端装备、新能源、电子信息等战略性新兴产业的核心器件，其自主化水平直接关系到产业链供应链安全稳定，因此我国积极推动产业链安全、制造业高质量发展、强化基础工业能力、以及攻克关键领域核心技术的国家战略导向。

2016年12月，由国家发展改革委会同科技部、工信部、财政部等部门牵头编制的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，将夯实工业基础、突破核心环节作为战略性新兴产业发展的重要支撑，推动核心器件技术攻关与供给能力提升，为半导体金属器件产业发展提供了战略指引；2021年12月由工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、科技部等八个部门联合发布的《“十四五”智能制造发展规划》提出攻克基础技术与核心器件瓶颈，支持核心器件研

发与产能扩张；2025年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》进一步明确“十五五”期间（2026-2030）集成电路产业发展目标：关键半导体设备国产化率突破70%。

一系列政策密集出台，明确了产业发展的战略定位，为半导体金属器件产业提供了全方位保障，本项目专注于半导体先进制程金属器件的研发与生产，与国家的战略导向高度契合，符合公司的发展规划与长期目标。

（2）具有成熟完备的工艺体系，明确技术升级路线

公司深耕半导体金属器件制造领域多年，已构建起覆盖原材料加工、精密加工、表面处理、焊接等全流程的成熟工艺体系，核心制造环节历经长期产业化验证与持续优化，形成了兼具稳定性与可靠性的工艺标准。在半导体关键金属器件生产中，公司积累了扎实的量产经验，能够确保产品在精度、性能等关键指标上的一致性与稳定性，为规模化生产奠定了实践基础。

依托长期的技术沉淀，公司在关键环节形成了显著优势，实现了生产流程实时跟踪与追溯，通过节点管理缩短制造周期，提高交付效率。针对金属器件的精密加工需求，公司有自主优化的成型工艺与焊接技术，是国内较早通过美国焊接学会（AWS）认证的焊接制造商（CWF），能够有效解决复杂结构件的精度控制难题，确保产品在严苛工况下的稳定运行；在表面处理环节，通过持续迭代的工艺方案，大幅提升了产品的耐磨性、耐腐蚀性与使用寿命，可灵活适配不同应用场景的高端需求，核心工艺经过长期实践检验，规避了基础工艺探索带来的技术不确定性，成为本次产能扩建的核心技术支撑。

公司持续跟踪行业技术发展趋势，聚焦产品性能提升与工艺优化，本次产能扩建并非全新技术的探索性应用，而是在现有成熟工艺平台上的规模扩大与精准升级，重点围绕现有产品的产能释放、高端产品的工艺迭代以及生产效率的优化提升展开，而非技术原理的未知性挑战。公司在工艺管控、生产组织等方面的丰富经验，以及完善的技术体系，能够有效保障本项目生产线扩增的顺利过渡与更新升级，实施风险总体可控。

（3）稳定的客户资源，为项目建立坚实市场基础

公司深耕国内半导体设备精密制造领域，经过多年的沉淀，积累了丰富的

客户资源。公司自设立时起即伴随中微公司、北方华创、拓荆科技等国产半导体设备龙头企业共同成长，深度参与客户多款先进设备的研发、定型和迭代升级。半导体高端装备奉行严格复制信条，即客户要求严格复制已经确立的工艺标准，基于此，公司与中国本土装备龙头企业的长期稳定合作形成了深厚的信任基础，建立了与客户协同迭代开发的持续反馈机制。

同时，公司较早确立了陪伴国内半导体设备厂商成长的经营理念，在半导体设备产业链安全的国产化浪潮中具有先发优势，伴随国产半导体设备需求量的提升，公司的业绩成长确定性较强。公司凭借稳定的产品性能、精准的技术适配能力及高效的供应链响应速度，已与国内多家主流半导体设备制造商建立起长期稳固的战略合作关系，形成了结构合理、粘性较强的核心客户群体。这一合作体系是基于多年来在产品质量管控、技术协同创新、交付周期保障等多方面的持续投入与验证，双方构建起互信共赢的长期合作机制，为市场需求的稳定性提供了核心支撑。

当前半导体设备行业正处于技术迭代加速与产能扩张的关键阶段，公司核心客户均在推进高端制程设备的研发与量产，同时持续扩大产能规模以满足下游芯片制造行业的增长需求。半导体金属器件作为半导体设备的核心功能组件，其性能直接影响设备的运行精度与稳定性，是客户产能扩张与技术升级过程中不可或缺的关键配套。未来 3-5 年，客户需求增长趋势清晰、采购意向稳定，长期合作形成的需求预判机制为项目新增产能提供了直接且可靠的市场出口，也为项目经济效益的稳步实现提供了保障。

4、项目投资概算

本项目总投资金额为 30,401.55 万元，拟使用募集资金投入金额为 28,750.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额
1	工程建设投资	18,160.78	17,600.00
2	设备及软硬件投入	9,348.30	9,000.00
3	项目预备费	550.18	550.00
4	铺底流动资金	2,342.29	1,600.00

序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额
	合计	30,401.55	28,750.00

5、项目经济效益分析

本项目具备良好的经济效益。项目建成达产后预估年均营业收入 37,284.89 万元，年均净利润 8,410.95 万元，年均毛利率为 40.62%，年均净利率为 22.60%。项目预计税后内部收益率为 16.65%，税后静态投资回收期为 6.48 年。

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

（1）营业收入预计

本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，并根据各年预计销量情况测算得出。项目建成后，达产年的预计销售收入为 39,176.55 万元。

（2）营业成本及费用测算

本项目的产品成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用。直接材料参考各产品材料采购成本计算；人工成本按项目计算期需用员工人数及公司目前员工薪酬水平进行估算；制造费用中，固定资产按年限平均法直线折旧，无形资产按年限平均法直线摊销，其他费用按照销售收入的一定比例测算。

（3）税金及附加

本项目增值税税率 9%、13%；城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提；实施主体所得税率 15%。

7、项目备案、环评情况

本项目的备案手续已完成，并取得备案证“靖数备〔2026〕339 号”。

本项目的环评批复已完成，并取得关于《江苏先锋精密科技股份有限公司先锋精科半导体先进制程核心工艺器件研发制造项目环境影知响报告表的批复》（泰环审（靖江）〔2026〕22 号）。

（二）半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目

1、项目基本情况

本项目的实施主体为江苏先锋精密科技股份有限公司，建设地点位于江苏省靖江市斜桥镇罗家村、柏一村（新兴路以北、新泰路以西、新旺路以南地块），项目总投资额为 26,470.57 万元，拟使用本次募集资金金额为 25,050.00 万元。

本项目中，公司将基于自身在半导体设备精密零部件及高端器件领域多年的技术积累，结合半导体行业向先进制程演进及核心部件突破创新的发展趋势，对半导体先进制程非金属材料及器件开展研发及产业化。项目建设有利于公司打破国外技术垄断、完善产品布局、提升在细分市场的竞争力与占有率。

2、项目实施的必要性

（1）填补国内缺口，提升公司细分领域市场地位

半导体先进制程非金属材料及器件，特别是陶瓷加热器，是半导体设备中实现高温、高均匀性的核心关键器件。其性能直接决定了薄膜沉积、刻蚀等关键工艺中的温度精度、能耗效率与长期运行可靠性。长期以来，该领域的高端市场被日本、美国等国际少数巨头所垄断，国内设备厂商严重依赖进口，这不仅带来高昂的采购成本与漫长的供应周期，更构成了半导体产业链安全战略中突出的关键环节。随着国内半导体设备行业的加速突破，下游龙头客户对于实现此类高性能陶瓷器件国产化、保障供应链安全与技术自主的需求已变得极为明确和紧迫。

在此背景下，国内具备量产能力并得到行业认可的供应商极为稀缺，市场存在显著的供给缺口。这为公司切入该赛道、确立先发优势提供了机遇。因此，实施本半导体先进制程非金属材料及器件研发、生产新建项目，其核心战略意义在于填补国内在该领域的产能缺口。

本项目是对已明确存在的国内半导体核心功能器件需求的直接响应。通过项目建设形成规模化的半导体先进制程非金属材料及器件供应能力，公司将能解决下游战略客户的痛点，从当前金属器件供应商升级为覆盖金属与陶瓷两大核心材料体系的半导体关键器件供应商。成功实施本项目，意味着公司将在国

内半导体设备产业链中，占据一个技术壁垒更高、附加值更大、竞争格局更优的位置，从而根本性地提升公司在细分领域的市场地位。

（2）开辟全新增长曲线，优化公司产品与盈利结构

当前，半导体制造技术向先进制程的快速演进，对设备核心模块的性能与集成度提出了系统性升级要求。半导体功能器件（如陶瓷加热器）具备独立、完整的物理功能与电气特性，是直接决定设备工艺性能的核心模块，其技术壁垒与附加值远高于基础结构件。然而，此类高端功能器件市场目前主要由少数国际厂商主导，是我国半导体产业链安全的关键短板之一。

公司长期深耕半导体设备金属零部件制造，已建立稳固的市场地位和成熟的工艺体系。但单一依赖金属零部件产品，使公司业务结构与盈利能力面临瓶颈，难以充分适应下游技术快速迭代和材料升级的趋势。实施本半导体先进制程非金属材料及器件研发、生产新建项目，是公司主动进行战略扩张的关键举措。本项目旨在将公司的核心制造能力，从成熟的金属器件领域，拓展至技术壁垒更高、附加值更大的半导体先进制程非金属器件领域。

通过本项目的建设，公司将构建国内稀缺的半导体先进制程非金属材料及器件全流程量产能力，实现产品矩阵从金属到非金属的重要扩充。这不仅能够直接响应下游客户对先进制程装备的迫切需求，更能为公司开辟一条极具成长潜力的全新业务增长曲线。项目成功实施后，公司将形成金属与非金属器件并重的产品格局，显著优化产品结构，提升整体解决方案能力。同时，半导体先进制程非金属器件通常享有更高的毛利率，其规模化生产将有力提高公司的盈利能力，增强抗风险能力。因此，本项目是公司优化业务布局、提升综合竞争力的重要战略步骤。

（3）适配更高阶的工艺控制需求，满足公司战略发展需要

半导体设备技术的快速迭代，对相关功能器件的制造环境与工艺控制提出了极为严苛的要求。当前，全球半导体产业持续扩张，下游市场对高性能、高可靠性器件的需求规模迅速增长，为公司带来了重要的战略机遇。然而，公司现有生产场地的物理空间与环境控制能力存在一定限制，无法建设和维护高规格生产环境，也难以针对新一代半导体材料加工进行大规模、专用化的产线布

局与工艺深化。

现有场地在环境参数的精准与稳定控制方面存在根本性瓶颈，难以满足高端制造对关键指标的长期稳定要求。这导致部分关键工序无法在内部完成，产品性能难以达到高端客户规格，成为公司获取高端市场份额的核心障碍。同时，对于需要部署大型专用设备及独立环境控制单元的新材料工艺研发与量产线，现有空间布局已无法容纳，严重制约了公司工艺能力的纵向拓展。

为把握下游市场规模增长带来的机遇，并满足客户对器件性能高阶要求，公司必须构建具备高阶工艺控制能力的制造基地。本项目的实施，旨在通过建设高标准生产设施，突破上述发展制约。项目将规划建设满足高阶环境控制要求的各类洁净加工与装配区域，并配套引入面向新一代材料与精密制造的关键工艺装备，构建起支持未来技术迭代的先进工艺平台。

本项目直接响应了下游市场对产品技术指标的持续提升需求，通过建立先进制造能力，不仅能巩固与现有战略客户的合作，更有助于切入高端市场，服务更广泛的客户群体。建设一个具备高阶工艺控制标准的制造基地，是公司突破当前发展瓶颈的必然选择。本项目通过提供与之相适应的硬件设施与工艺平台，将为公司巩固行业领先地位奠定坚实基础。

3、项目实施的可行性

（1）拥有扎实的技术储备，为项目实施构筑稳固技术根基

公司已在半导体先进制程非金属材料及器件领域完成了系统性、前瞻性的技术布局与研发储备，形成了覆盖“材料-工艺-装备-测试”的完整技术链，为本项目的产业化落地构筑了坚实的根基。

在材料体系与核心工艺方面，公司已深度介入氮化铝陶瓷的研发全流程。根据已有研发项目，公司明确了以粉末冶金为核心的技术路线，对 AlN 原料粉末选型与造粒、常压/热压烧结等关键环节进行了专项技术攻关规划，旨在实现高导热率、低烧结变形的高性能半导体先进制程非金属材料及器件制备。针对加热器核心结构，公司已开展多层加热盘埋丝设计与热压成形、陶瓷粘接剂配方开发以及高温热压接合等先进工艺研究，以解决内部介质层均匀性、气密性及连接可靠性等技术难点。

在专用技术与装备层面，公司基于研发和生产目标，已规划了覆盖全工艺流程的专用设备方案，包括球磨、喷雾造粒、干袋压机、热压接合炉及各类精密加工与检测设备。

公司对半导体先进制程非金属材料及器件研发、生产新建项目的技术攻坚已形成系统性的设计、清晰的工艺路线图和具体的研发行动计划。扎实的前期工作与技术储备，确保了本项目能够从一个目标明确、路径清晰的研发状态，高效有序地过渡到规模化量产，显著降低了技术不确定性带来的产业化风险。

(2) 利用现有客户渠道资源，缩短新产品市场导入周期

公司在半导体设备领域长期深耕，已与国内龙头半导体设备制造商建立了稳定深入的战略合作关系，并已进入其核心供应链体系。这一成熟的客户基础与销售渠道，为非金属材料及器件新产品的市场导入提供了优势，能显著缩短市场开拓周期，降低推广成本。

公司现有客户正是国产半导体先进制程设备的主要研发与生产者，其对更高性能、更高可靠性的半导体先进制程非金属材料及器件有明确且迫切的需求。公司的新产品研发方向直接响应了客户设备升级需求，市场对接精准，无需从零开始培育客户。凭借在半导体设备领域长期合作所建立的品质信誉，新产品可以借助现有合作关系，更顺畅地与客户对接。公司对客户的采购标准有深刻理解，能够更有针对性地进行产品开发与验证，从而加速样品测试、小批量试用直至批量供应的全过程。

半导体先进制程非金属材料及器件与现有产品在部分设备中属于配套关系。公司可利用现有产品线提供整体解决方案，增强客户黏性，同时带动新产品的销售。客户也更倾向于向已证明可靠性的一级供应商采购新品类产品，以降低供应链管理复杂度与风险。本项目并非面向陌生市场进行开拓，而是对现有客户需求的价值延伸。现有客户资源将成为新产品快速实现市场突破、形成初始销售规模的最有力保障，极大地提高了项目的市场成功率和投资回报确定性。

(3) 具备高层次技术团队，为工艺优化与量产建立人才基础

本项目的成功实施与后续高效量产，高度依赖于一支具备深厚理论功底与

工程实践经验的技术团队。公司已前瞻性地围绕陶半导体先进制程非金属材料及器件这一战略方向，构建了一支结构合理、专业覆盖完整的核心技术队伍。这支团队是确保前沿技术从实验室成功走向产业化、并实现持续工艺优化与稳定量产的关键保障。

团队构成具备显著的跨学科优势，与项目技术链条高度匹配。根据研发团队组织架构，核心成员的专业背景精准覆盖了从材料科学到精密制造的完整价值链。这种多元化的知识结构，使得团队能够深入理解并协同攻关半导体先进制程非金属材料及器件涉及的一系列复杂且相互关联的工艺环节。这种深度交叉融合的能力，是解决关键工艺难题不可或缺的基础。

公司已建立起体系化的研发管理机制与高效的技术攻关能力，完成了陶瓷加热器项目的正式立项与资源规划，其中部分产品已完成小试并投入小批量生产。该计划明确了包括材料制备、成型烧结、特种连接、性能测试等在内的数十项标志性技术节点，体现了公司对技术实现路径的深刻理解与周密部署。公司能够围绕明确的技术节点，调配各部门相关资源，确保攻关任务的有序推进。在项目执行中，公司建立了职责清晰、协同高效的工作模式，由核心技术人员牵头各关键技术环节，辅以多职能团队的支持，形成了目标导向、权责分明的协作体系。

公司现有的高层次、跨领域技术团队，是项目从技术研发成功跨越至产业化成功的核心保障。他们的专业知识与工程实现能力，将确保项目在后续的过程中，能够有效应对挑战，实现快速稳健的产业化目标。

4、项目投资概算

项目总投资额为 26,470.57 万元，拟使用本次募集资金金额为 25,050.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额
1	工程建设投资	11,701.03	11,000.00
2	设备及软硬件投入	12,000.00	12,000.00
3	项目预备费	493.13	450.00
4	铺底流动资金	2,276.41	1,600.00

序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额
	合计	26,470.57	25,050.00

5、项目经济效益分析

本项目具备良好的经济效益。项目建成达产后预估年均营业收入 34,991.70 万元，年均净利润 8,613.07 万元，年均毛利率为 42.89%，年均净利率为 24.62%。项目预计税后内部收益率为 24.22%，税后静态投资回收期为 6.00 年。

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

（1）营业收入预计

本项目营业收入的测算系以市场调研销售单价为基础，结合未来发展趋势，及各年预计销量情况测算得出。项目建成后，达产年的预计销售收入为 36,064.00 万元。

（2）营业成本及费用测算

本项目的产品成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用。由于公司相关产品尚未量产，上述产品成本细分科目采用同行业可比公司相关数据作为测算依据。

除营业成本外的其他费用中，销售费用、管理费用采用报告期内发行人自身费用占比平均值，考虑到本项目产品尚未大规模量产，谨慎考虑，研发费用采用高于报告期内费用占比平均值、按 6% 测算。

（3）税金及附加

本项目境内主体按照增值税税率 9%、13%；城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加分别按照增值税的 7%、3%、2% 进行计提；所得税率 15%。

7、项目备案、环评情况

本项目的备案手续已完成，并取得备案证“靖数备〔2026〕339 号”。

本项目的环评批复已完成，并取得关于《江苏先锋精密科技股份有限公司先锋精科半导体先进制程核心工艺器件研发制造项目环境影知响报告表的批

复》（泰环审（靖江）〔2026〕22号）。

（三）半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为江苏先锋精密科技股份有限公司，建设地点位于中国江苏省靖江市斜桥镇罗家村、柏一村（新兴路以北、新泰路以西、新旺路以南地块），项目总投资额为 5,911.37 万元，拟使用本次募集资金金额为 5,200.00 万元。

公司将围绕高性能介电层陶瓷材料精密烧结、微纳电极图案化制备、异质材料高可靠连接、多区精准温控等核心技术难点，开展全链条技术攻关与产品研发，实现陶瓷基板孔隙率低于 0.01%（4N 及以上）的精密烧结工艺、高精度图案化设计以均匀分布电场，同时达到陶瓷介电层、电极层及基底层等异质材料层间在严苛热循环下的高可靠、低热阻连接，开发出超 100 温区的分区温控技术。项目实施将有助于填补国内高端陶瓷静电吸盘供应空白，推动半导体设备产业链安全进程，进一步巩固公司在半导体核心零部件领域的领先地位。

2、项目实施的必要性

（1）有利于突破关键技术壁垒，提升公司自主创新能力

静电吸盘（ESC）作为半导体刻蚀与薄膜沉积设备中固定、控温及传导射频信号的核心部件，其技术性能直接决定先进制程工艺的精度与稳定性，属于我国半导体设备产业链中亟待突破的关键环节。当前，全球半导体制造正加速向 7nm 及更先进制程演进，对静电吸盘的精度、可靠性及耐等离子体腐蚀性能提出了近乎苛刻的要求，国内高端市场长期被海外厂商垄断，已成为制约国产设备竞争力与产业链安全的突出短板。因此，攻克并掌握静电吸盘的自主设计与制造技术，是公司直面行业最严峻挑战、履行产业链核心企业责任的必然选择。

同时，伴随下游半导体设备国产化进程的加速与深入，国产供应链正从工艺部件、结构部件等外围部件向静电吸盘、射频电源等核心子系统深化，这一趋势对从业企业的技术纵深、跨学科研发能力及与主机设备的协同创新提出了前所未有的更高要求，企业必须在巩固现有精密制造优势的基础上，向材料科

学、静电学、热力学及先进陶瓷工艺等前沿领域进行战略性拓展，实现从“制造”到“创造”、从“配合研发”到“定义系统”、从“跟跑”到“并跑”的能力跃迁。本项目正是公司为应对这一根本性挑战，通过集中资源攻克最尖端瓶颈，从而推动自身研发体系升级、构建技术护城河的关键举措。

目前，公司凭借在半导体设备精密零部件领域深耕多年的技术积累，已成为国内领先的设备厂商的核心供应商，本研发项目建成后，公司将系统构建静电吸盘从设计仿真、材料制备到精密加工、测试验证的全链条自主能力，显著提升公司在跨学科技术融合、原始创新与系统集成方面的核心能力，从而将公司的创新水平推升至新高度，为抢占下一代半导体设备技术制高点、开拓更广阔的战略市场奠定坚实基础。

（2）有利于攻克核心部件技术壁垒，巩固公司技术领先优势

静电吸盘的研发，是公司主动响应并引领半导体设备精密零部件领域深刻技术变革的战略举措，是面向产业核心瓶颈的一次前瞻性战略卡位，是规避未来技术断层风险、构筑长期竞争优势的必要举措。

当前，下游应用领域对核心部件的性能要求正经历根本性提升，具体体现在对产品的高洁净度、超强耐腐蚀能力、高可靠性与长使用寿命等综合性指标的极致追求上，这些需求迭代的速度远超传统产品。若不及早布局静电吸盘这类必需功能部件的自主研发与突破，将无法参与未来高端市场的竞争，这意味着，一旦客户工艺向更先进节点迈进，公司将难以应对客户快速升级的工艺要求，可能面临核心技术供给与市场需求脱节的风险，现有技术领先地位将被削弱。

同时，静电吸盘的技术能力是打开未来高价值功能器件市场的“钥匙”，代表超精密、高可靠的技术体系，其应用场景正从集成电路制造快速向第三代半导体、高端显示面板、先进光伏以及半导体高端封装等更为广阔的泛半导体领域扩展，这些新兴领域对精密控温与静电吸附解决方案有着明确而迫切的需求，项目的实施，掌握进入新兴战略市场的核心技术能力，从而为公司开辟全新的增长轨道。

通过本项目的实施，公司将系统性地整合研发资源，针对高性能材料、精

密加工工艺、极端环境耐受性等关键技术瓶颈进行集中攻关，驱动公司建立起能够持续应对下一代技术挑战的、动态演进的核心技术平台，确保公司技术路线与行业演进方向同步，从而在未来竞争格局中占据领先地位。

（3）有利于优化产品盈利结构，提升公司核心价值

实施静电吸盘研发项目，是公司突向高附加值核心功能部件领域进行战略性延伸的关键一步，对于从根本上优化产品与利润结构、提升公司在产业链中的核心价值地位具有决定性意义，当前，公司产品虽已覆盖半导体设备关键工艺部件领域并获认可，但产品附加值和技术壁垒存在提升空间。随着市场竞争加剧及成本压力传导，单一依靠扩大规模或成本控制的盈利模式可持续性面临挑战。相比之下，静电吸盘作为直接决定设备工艺性能的核心子系统，其技术密集、研发驱动、客户粘性强的特点，决定了其具有远高于普通结构件的毛利率和市场定价权。

静电吸盘的产业化意味着由核心技术驱动的高毛利产品占比将获得显著提升，这将有效增强公司盈利的稳定性和抗周期性，减少对中低附加值产品市场的依赖。同时，掌握静电吸盘这一核心部件技术，将使公司从设备制造商的供应商升级为不可或缺的技术合作伙伴，从而在商业谈判、价值分配中占据更有利地位，提升整体盈利能力。

一家拥有高端核心部件自主研发能力、且该部件具备稀缺属性的企业，将获得更高的技术估值和品牌溢价。通过本项目构建的完整研发与量产体系，不仅能直接贡献利润，更能作为强大的技术平台，支撑未来系列化高端功能部件的快速孵化，形成持续的价值增长曲线。因此，本项目是公司优化短期财务结构、布局长期价值增长的战略性投资，将有力驱动公司从一家优秀的精密制造企业，向引领细分领域技术方向、定义市场标准的平台型科技公司跃迁。

3、项目实施的可行性

（1）符合国家前沿技术攻关与未来产业发展导向

半导体设备及其核心精密零部件是支撑信息技术产业发展的基石，属于国家战略性新兴产业的关键环节，其技术水平直接关系到产业链的安全与竞争力。当前，全球科技竞争日益聚焦于前沿技术与高端制造能力，而静电吸盘作

为半导体制造设备中晶圆处理的核心部件，推动此类核心基础部件的突破，不仅是产业发展的内在需求，更是响应国家战略号召、把握未来产业发展主动权的必然选择。

我国高度重视制造业特别是高端装备与核心技术的自主创新与发展。2015年，国务院明确提出将“创新驱动”置于制造业发展全局的核心位置，强调要“强化工业基础能力”，攻克一批关键共性技术与核心基础部件；同时，国家持续通过《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等政策工具，明确将“集成电路装备”及其关键零部件列为鼓励发展的重点领域，引导社会资源投向产业短板环节；此外，为全面提升产业竞争力，国家多部委联合推动《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》，特别指出要在“关键原材料、基础零部件、电子元器件”等基础领域实现质量可靠性突破，打造精品装备，这些顶层设计共同构成了以创新为动力、以基础能力为支撑、以质量品牌为目标的产业发展政策体系。

本项目的实施精准对接了国家战略导向，项目致力于攻克半导体设备领域的一项关键零部件，直接服务于提升我国集成电路装备的自主化水平与产业链安全性，属于国家明确鼓励和支持的前沿技术攻关范畴，是顺应国家前沿技术攻关与未来产业发展方向的战略性投资，将为公司赢得宝贵的发展机遇和广阔的政策空间。

（2）专业团队与客户协同验证为项目提供保障

本研发项目的实施，有公司内部长期积淀的专业技术团队作为核心驱动力和坚定保障，同时拥有与头部设备厂商深度绑定的验证机制，这共同构成了项目成功推进的坚实基础与独特优势。公司已构建了一支涵项目管理的核心团队，该团队由具备多年行业背景的资深专家领衔，成员覆盖战略规划、产品设计、先进制造、测试验证及产业化管理全链条，团队核心管理人员拥有成功主导复杂精密部件从研发到规模量产的全过程经验，深刻理解半导体设备行业的质量体系与供应链管理要求，能够确保项目在技术路径、资源调配与风险控制上高效协同。

公司主要客户现已覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、华海清科、拓荆

科技、屹唐股份等知名半导体产业链厂商，长期陪伴国产半导体设备厂商发展、紧密配套，作为核心零部件的重要供应商协助客户诸多设备经历了研发、定型、量产和迭代至先进制程的完整历程，确保静电吸盘的研发方向始终与客户最前沿的工艺需求及设备升级路径紧密对齐。通过客户提供的产线测试机会和验证反馈通道，项目团队能够对原型设计进行快速迭代与优化，在真实应用场景中完成性能标定与工艺适配。

这种研发与市场无缝对接、创新与验证同步进行的闭环机制，极大地压缩了产品开发周期，显著提升了技术方案的成熟度与产业化成功率，为项目攻克工程化难题并最终实现商业落地提供了至关重要的双重保障。

（3）公司深厚的技术积淀为项目实施提供坚实基础

公司在半导体设备精密零部件领域长达十余年的专注深耕，已构建了完整且被行业验证的技术研发与制造体系，这为本项目的成功实施提供了坚实可靠的技术底层支撑。公司持续保持高强度的研发投入，近三年研发投入复合增长率超 **25%**，并建立了“江苏省基于 **5 纳米**芯片工艺刻蚀设备 **PM** 模块工程研究中心”等省级创新平台。

经过多年自主研发，公司具备了金属零部件精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术、高性能陶瓷制备及精加工技术和定制化工装开发技术等多项领先技术开发体系。截至 **2026 年 3 月 31 日**，公司各项精密制造技术已形成 **135** 项获批专利，其中发明专利 **38** 项、实用新型 **97** 项，全部应用于公司主营业务。公司凭借这些技术积累，已成为国内极少数能够量产供应 **7 纳米**及以下先进工艺刻蚀设备关键零部件的制造商，其产品在北方华创、中微公司等龙头企业的核心设备中实现了长期稳定可靠的应用验证。

这种从基础工艺到复杂系统件、从技术开发到规模化量产的完整能力闭环，特别是公司在应对极端洁净、高精度、耐等离子体腐蚀等严苛工况方面所积累的独到工艺诀窍和庞大的工程数据库，为静电吸盘这类涉及多学科、多工艺集成的超精密核心部件的自主研发，扫清了从材料选型、结构设计到工艺实现路径上的大量不确定性，确保了项目能够基于可靠的技术起点向更高的创新

目标迈进。

4、项目投资概算

项目总投资额为 5,911.37 万元，拟使用本次募集资金金额为 5,200.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额
1	工程建设投资	627.00	550.00
2	设备及软硬件投入	3,590.00	3,500.00
3	研发投入	1,267.57	1,100.00
4	工装开发费用	355.00	-
5	项目预备费	71.80	50.00
合计		5,911.37	5,200.00

5、项目经济效益分析

本项目为研发类项目，不适用项目经济效益分析。

6、项目备案、环评情况

本项目的备案手续已完成，并取得备案证“靖数备〔2026〕339 号”。

本项目的环评批复已完成，并取得关于《江苏先锋精密科技股份有限公司先锋精科半导体先进制程核心工艺器件研发制造项目环境影知响报告表的批复》（泰环审（靖江）〔2026〕22 号）。

三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明

公司作为半导体设备核心精密零部件领域的领军企业，致力于以核心精密制造技术推动半导体产业国产化进程。公司主要产品为半导体设备核心精密零部件，根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务归属于“2 高端装备制造产业”，聚焦半导体专用设备核心零部件领域，属于国家重点支持的国产化范畴。

本次募投项目“半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目”，系公司对

现有优势产品的升级迭代与产能扩充，核心目的为顺应下游半导体设备扩产及先进制程技术迭代的行业趋势，进一步完善公司在半导体核心零部件领域的产品布局，精准匹配下游半导体设备厂商及晶圆厂的核心需求，巩固并提升公司在金属加热器领域的国内领先地位，满足成熟制程及先进制程对高可靠性加热部件的批量供应需求。

本次募投项目“半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目”，聚焦陶瓷加热器的关键技术攻关、核心组件研发及规模化生产，重点突破高纯度氮化铝粉体合成、薄膜电路共烧等核心技术壁垒。该项目的实施，有助于提升公司在半导体高端加热部件领域的核心竞争力，加速陶瓷加热器的国产化进程，打破国外厂商在高端领域的垄断格局，保障我国半导体产业链供应链安全。半导体专用设备核心零部件制造行业属于高新技术产业和战略性新兴产业，陶瓷加热器作为薄膜沉积等高精度工艺的核心关键部件，是半导体先进制程实现突破的重要支撑。

本次募投项目“半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目”，围绕半导体静电吸盘核心技术开展系统性攻关，重点聚焦氮化铝陶瓷基底制备、耐等离子体涂层、高压静电控制等关键技术环节，推进核心部件研发及整机组件研制。该项目的实施，有助于推动国产化静电吸盘方案落地应用，打破国外厂商在高端静电吸盘领域的技术垄断，实现核心零部件产业链安全与降本增效，同时满足先进制程对晶圆固定、精准温控的严苛技术要求，拓展半导体先进制程核心零部件的应用场景，助力我国半导体产业链实现自主安全发展。

综上，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向，均围绕科技创新领域开展，聚焦半导体设备核心精密零部件关键技术突破与产能升级，符合《注册管理办法》第十二条的相关规定。

（二）募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

半导体设备核心精密零部件行业属于典型的科技创新型产业，核心技术的积累及持续的技术创新能力，是企业掌握核心竞争优势的关键因素。将精密制造技术、材料技术与半导体工艺深度融合，应用于刻蚀、薄膜沉积等半导体核心制程场景，需在精密机械制造、材料科学、表面处理、加热电路集成、静电

夹持技术、真空密封技术等多个领域积累大量核心技术，跨越机械、材料、电子、半导体等多个学科领域，对生产厂商的技术水平、工艺积累提出了极高要求，尤其是先进制程对零部件的精度、可靠性、耐腐蚀性等指标要求更为苛刻。

公司自成立以来，始终高度重视自主创新，持续提升公司技术及产品的核心竞争力。经过十余年的持续研发与深度深耕，公司在半导体核心精密零部件核心技术的关键领域实现多项技术突破，构建了精密机械制造、表面处理、焊接、高端器件设计开发、高性能陶瓷制备及精加工技术及定制化工装开发等六大核心技术体系，部分产品已批量应用于 7nm 芯片生产线。

本次募投项目的实施，将助力公司将核心技术深度应用于丰富的半导体客户场景及广泛的下游制程领域，针对先进制程需求，持续对金属加热器、陶瓷加热器、半导体静电吸盘等核心产品进行升级迭代，精准把握下游半导体设备厂商及晶圆厂的核心需求，进一步突破高端产品技术壁垒，完善核心技术体系，巩固公司核心竞争力，推动公司从单一金属零部件供应商向“金属及非金属材料+关键功能器件”一体化解决方案提供商的战略转型，助力半导体核心零部件国产化进程加速推进。

四、本次募集资金投资项目的资本化情况

本次募投项目的资本性支出及非资本性支出具体构成如下所示：

单位：万元、%

项目名称	序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额	是否属于资本性支出	其中：资本性投入
半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目	1	工程建设投资	18,160.78	17,600.00	是	17,600.00
	2	设备及软硬件投入	9,348.30	9,000.00	是	9,000.00
	3	项目预备费	550.18	550.00	否	-
	4	铺底流动资金	2,342.29	1,600.00	否	-
	小计		30,401.55	28,750.00	-	26,600.00
半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目	1	工程建设投资	11,701.03	11,000.00	是	11,000.00
	2	设备及软硬件投入	12,000.00	12,000.00	是	12,000.00
	3	项目预备费	493.13	450.00	否	-
	4	铺底流动资金	2,276.41	1,600.00	否	-
	小计		26,470.57	25,050.00	-	23,000.00

项目名称	序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额	是否属于资本性支出	其中：资本性投入
半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	1	工程建设投资	627.00	550.00	是	550.00
	2	设备及软硬件投入	3,590.00	3,500.00	是	3,500.00
	3	研发投入	1,267.57	1,100.00	否	-
	4	工装开发费用	355.00	-	否	-
	5	项目预备费	71.80	50.00	否	-
	小计		5,911.37	5,200.00	-	4,050.00
补充流动资金项目	1	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	否	-
募投项目合计	非资本性支出合计		21,350.00			
	非资本性支出占比		28.47			

由上表可见，公司本次募投项目中非资本性支出为 21,350.00 万元，占本次发行拟使用募集资金总额的 28.47%，符合不超过 30% 的规定。

第六节 备查文件

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告及最近一期的财务报告；
- （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）会计师出具的关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；
- （五）盈利预测报告及其审核报告（如有）；
- （六）拟收购资产的评估报告及有关审核文件（如有）；
- （七）资信评级报告（如有）；
- （八）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
- （九）其他与本次发行有关的重要文件。

（此页无正文，为《江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书摘要》之盖章页）

江苏先锋精密科技股份有限公司

2026 年 8 月 3 日

